

关于深圳中科飞测科技股份有限公司  
向特定对象发行股票申请文件的  
审核问询函的回复

---

容诚专字[2025]518Z0385 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 目 录

3、关于融资规模与效益测算.....	2
4、关于经营情况.....	27
5、关于存货 .....	47
6、关于其他 .....	60

# 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复

容诚专字[2025]518Z0385 号

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 2 月 13 日出具的《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2025）12 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”或“申报会计师”）为深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中科飞测”）的申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见。现将审核问询函的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。

本问询函回复中的字体代表以下含义：

<b>审核问询函所列问题</b>	<b>黑体（加粗）</b>
对审核问询函所列问题的回复	宋体
<b>对问询回复的修改、补充</b>	<b>楷体（加粗）</b>

本问询函回复除特别说明外数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 3、关于融资规模与效益测算

根据申报材料：（1）公司本次募投项目拟融资规模 250,000.00 万元，主要用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（含“上海高端半导体质量控制设备产业化项目”和“上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目”）、总部基地及研发中心升级建设项目、补充流动资金；（2）公司本次募投项目中资本性支出金额为 150,000.00 万元，其中包括上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目的研发费用 10,000.00 万元，总部基地及研发中心升级建设项目的研发费用 20,000.00 万元，公司认为其符合“轻资产、高研发投入”特征。

请发行人说明：（1）公司本次募投各项目融资规模的具体构成，相关土地投资、建筑投资、设备及软件投资、研发费用等的测算依据及公允性；（2）结合“轻资产、高研发投入”的相关指标要求，说明本次募投非资本性支出占比情况，非资本性支出超过募集资金总额 30%的部分是否用于主营业务相关的研发投入；（3）结合公司持有货币资金、交易性金融资产及大额存单情况、资金缺口、资产负债率等指标，说明公司本次融资规模的合理性；（4）“上海高端半导体质量控制设备产业化项目”的销售单价、销量、毛利率等关键指标的测算依据，本次募投项目效益测算的谨慎性及合理性。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

#### 【回复】

##### 一、发行人说明

（一）公司本次募投各项目融资规模的具体构成，相关土地投资、建筑投资、设备及软件投资、研发费用等的测算依据及公允性

本次募集资金投资项目总投资规模为 285,186.74 万元，涉及高端半导体设备研发产业化项目（含“高端半导体设备产业化项目”和“高端半导体设备研发项目”两个子项目）、总部基地及研发中心升级建设项目、补充流动资金，具体情况如下：

## 1、上海高端半导体质量控制设备产业化项目

本项目规划总投资 84,572.98 万元，其中拟投入募集资金 73,400.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	3,257.66	3.85%	3,200.00	4.36%
2	建筑投资	65,501.63	77.45%	65,500.00	89.24%
3	设备及软件投资	4,741.96	5.61%	4,700.00	6.40%
4	预备费	3,512.18	4.15%	-	-
5	铺底流动资金	7,559.54	8.94%	-	-
合计		<b>84,572.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>73,400.00</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 土地投资

上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目总用地面积为 48,321.00 平方米，预计土地购置费用为 4,832.10 万元，土地购置折合单价预计为 0.10 万元/平方米，主要系结合当地土地价格及募投用地区域情况等因素综合考虑预估。其中涉及上海高端半导体质量控制设备产业化项目和上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目两个子项目，位于同一宗土地上，子项目用地面积系根据项目规划建筑面积进行分摊。

本次募投项目所涉地块为工业用地，公司项目用地购置单价与上市公司上海地区可比项目对比情况如下：

单位：万元/平方米

公司名称	项目名称	土地购置单价
中微公司	中微临港产业化基地	0.11
盛美上海	盛美半导体设备研发与制造中心	0.15
发行人	上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目	0.10

注：上海高端半导体质量控制设备产业化项目和上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目位于同一宗土地，项目用地面积系根据项目规划建筑面积进行分摊。

由上可见，本次募投项目土地性质为工业用地，预计购置单价与同行业上市

公司上海地区可比项目用地购置单价基本相当，具有公允性。

## (2) 建筑投资

本项目建筑投资费用主要由建筑工程费用和工程建设其他费用组成，具体构成如下：

单位：万元

序号	具体项目	金额	占比
1	建筑工程费用	61,831.63	94.40%
2	工程建设其他费用	3,670.00	5.60%
合计		<b>65,501.63</b>	<b>100.00%</b>

### ①建筑工程费用

本项目拟新建生产区域、配套功能区域、行政办公区域等建筑，配套功能区域主要包括员工公寓、员工活动中心等。建筑工程费用根据建筑面积及单位造价确定，具体建筑面积系公司结合募投项目相关生产、原材料及产成品仓储等所需场地空间，并综合考虑辅助生产设施、相关人员的办公场所等所需空间确定；单位造价根据同类项目建设预算情况、市场类似工程相关技术经济指标以及本项目实际建设需求进行合理估算。

本项目建筑工程费用具体测算明细如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目	工程量	单位造价	费用合计
1	生产区域			
1.1	洁净车间	26,408.90	1.02	26,937.08
1.2	洁净仓库	39,408.10	0.53	21,065.37
2	配套功能区域	19,570.00	0.42	8,219.40
3	行政办公区域	7,526.92	0.42	3,161.31
4	架空连廊区域	5,829.70	0.42	2,448.47
合计		<b>98,743.62</b>		<b>61,831.63</b>

### ②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用结合公司历史厂房建设经验和市场价格等进行合理估算，具体测算明细如下：

单位：万元

序号	项目	费用金额	测算依据
1	建设单位管理费	500.00	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定进行估算
2	前期工作费	60.00	包括可行性研究、环境评估等费用，公司综合考虑市场公开价格、项目实际情况等因素进行合理估算
3	勘察设计费	860.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.4%进行大致估算
4	临时设施费	600.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.0%进行大致估算
5	工程监理费	900.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.5%进行大致估算
6	工程保险费	750.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.2%进行大致估算
合计		<b>3,670.00</b>	-

本项目包括建筑工程费用和工程建设其他费用在内的建筑投资与上市公司可比项目对比如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

公司名称	项目名称	工程量	建筑投资总额	单位造价
中微公司	中微临港产业化基地	180,000.00	140,000.00	0.78
微导纳米	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	16,000.00	10,255.00	0.64
本项目		<b>98,743.62</b>	<b>65,501.63</b>	<b>0.66</b>

注1：中微公司、发行人工程建设总额包含工程建筑其他费用；

注2：微导纳米半导体薄膜沉积设备智能化工厂工程建设总额为租赁厂房装修费用

由上可见，本项目单位造价与同行业上市公司可比项目的单位造价不存在显著差异。

综上所述，本项目建筑投资费用的测算具有公允性。

### （3）设备及软件投资

本项目所需软硬件设备价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格、供应商报价等因素进行合理估算。本项目所需的软硬件设备包含生产设备、厂务及质量设备、行政办公设备以及相关软件等，具体构成如下：

单位：万元

序号	具体项目	金额	占比
1	生产设备、厂务及质量设备、行政办公设备等硬件设备购置费	4,191.96	88.40%
2	软件购置费	550.00	11.60%
合计		<b>4,741.96</b>	<b>100.00%</b>

其中，单项设备采购总金额超过 200 万元的购置情况如下：

单位：台/套、万元

序号	名称	数量	单价	预算金额	测算参考依据
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	600.00	参考公司同类或相似设备历史采购价格进行合理估算
2				440.00	
3				400.00	
4				400.00	
5				300.00	结合市场公开价格合理估算
6				300.00	参考公司同类或相似设备历史采购价格进行合理估算
7				250.00	结合市场公开价格合理估算
8				240.00	参考公司同类或相似设备历史采购价格进行合理估算
合计				<b>2,930.00</b>	-
占比				<b>61.79%</b>	-

本项目生产相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，采购价格主要系综合考虑公司同类或相似设备历史采购价格、供应商市场报价等因素进行合理估算，具有公允性。

## 2、上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目

本项目计划投资总额 63,516.33 万元，其中拟投入募集资金 44,600.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	1,574.44	2.48%	1,500.00	3.36%
2	建筑投资	22,901.09	36.06%	22,900.00	51.35%
3	设备及软件投资	10,252.14	16.14%	10,200.00	22.87%
4	预备费	1,657.66	2.61%	-	-
5	研发费用	27,131.00	42.71%	10,000.00	22.42%
合计		<b>63,516.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,600.00</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 土地投资

本项目和上海高端半导体质量控制设备产业化项目位于同一宗土地上，用地面积系根据项目规划建筑面积进行分摊。本项目土地投资用地土地购置折合单价与上海高端半导体质量控制设备产业化项目相同，主要系结合当地土地价格及募投用地区域情况等因素综合考虑预估，具备公允性。

### (2) 建筑投资

本项目建筑投资费用主要由建筑工程费用和工程建设其他费用组成，具体构成如下：

单位：万元

序号	具体项目	金额	占比
1	建筑工程费用	21,426.09	93.56%
2	工程建设其他费用	1,475.00	6.44%
合计		<b>22,901.09</b>	<b>100.00%</b>

#### ①建筑工程费用

本项目拟新建研发测试用房、研发办公区域、地下建筑区域等建筑，地下建筑区域主要包括地下设备用房、消防水池、地下车库等。建筑工程费用由建筑面积及单位造价确定，具体建筑面积系公司结合募投项目相关研发测试活动所需场地空间，并综合考虑相关人员的办公场所等所需空间确定；单位造价根据同类项目建设预算情况、市场类似工程相关技术经济指标以及本项目实际建设需求进行

合理估算。

本项目建筑工程费用具体测算明细如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目	工程量	单价造价	费用合计
1	研发测试用房	19,680.00	0.60	11,808.00
2	研发办公区域	12,043.08	0.42	5,058.09
3	地下建筑区域	16,000.00	0.29	4,560.00
合计		<b>47,723.08</b>		<b>21,426.09</b>

注：地下建筑区域主要包括地下设备用房、消防水池、地下车库等

### ②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费等，主要系公司综合考虑市场公开价格及项目实际情况等因素进行合理估算，具体测算明细如下：

单位：万元

序号	项目	费用总额	测算依据
1	建设单位管理费	310.00	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定进行估算
2	前期工作费	30.00	包括可行性研究、环境评估等费用，公司综合考虑市场公开价格、项目实际情况等因素进行合理估算
3	勘察设计费	305.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.4%进行大致估算
4	临时设施费	230.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.0%进行大致估算
5	工程监理费	350.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.5%进行大致估算
6	工程保险费	250.00	公司结合市场公开价格，按建筑工程费用总额1.2%进行大致估算
合计		<b>1,475.00</b>	-

本项目包括建筑工程费用和工程建设其他费用在内的建筑投资与上市公司可比项目对比如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

公司名称	项目名称	工程量	工程建设总额	单位造价
芯源微	上海临港研发及产业化项目	51,391.59	26,360.90	0.51
发行人	上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	47,723.08	22,901.09	0.48

注：工程建设总额包含工程建筑其他费用

由上可见，本项目单位造价与同行业上市公司可比项目的单位造价不存在显著差异。

综上所述，本项目建筑投资费用的测算具有公允性。

### （3）设备及软件投资

本项目所需的软硬件设备包含工艺测试平台、研发相关辅助软硬件设备以及相关软件等，具体构成如下：

单位：台/套、万元

序号	具体项目	金额	占比
1	工艺测试平台、研发相关辅助设备 etc 硬件设备购置费	10,132.14	98.83%
2	软件购置费	120.00	1.17%
合计		<b>10,252.14</b>	<b>100.00%</b>

其中，单项设备采购预算金额超过 200 万元的购置情况如下：

单位：台/套、万元

序号	名称	数量	单价	预算金额	测算参考依据
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	5,550.00	根据同类或类似设备采购或自建价格、供应商市场报价等因素进行合理估算
2				1,450.00	
3				360.00	
4				360.00	
5				350.00	
6				300.00	
7				280.00	
8				200.00	

序号	名称	数量	单价	预算金额	测算参考依据
9				200.00	
合计				<b>9,050.00</b>	-
占比				<b>88.27%</b>	-

本项目生产相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，采购价格主要系根据同类或类似设备采购或自建价格、供应商市场报价等因素进行合理估算，具有公允性。

#### （4）研发费用

项目研发费用为建设期内开展相关设备研发所需研发人员薪酬、研发材料费用以及其他研发费用等，共计 27,131.00 万元。

##### ①研发人员薪酬

本项目研发人员薪酬为 17,131.00 万元，主要由研发人员数量及人均薪酬构成。研发人员数量主要系根据研发规划预估研发投入人员数量，本项目拟投入研发人员 310 人。研发人员薪酬主要系根据公司历史研发人员薪酬水平、项目所在地区人均薪酬水平等因素进行合理估算。本项目研发人员人均薪酬为 48.39 万元/年，2021 年度至 2023 年度公司研发人员人均薪酬为 46.10 万元/年，本项目研发人员人均薪酬与公司历史年度水平基本相当，具有公允性。

##### ②研发材料费用及其他研发费用

本项目研发材料费用、其他研发费用（差旅费、技术服务费、知识产权相关费用等）主要系综合考虑公司历史研发费用结构、研发项目实际需要进行合理估算，具体明细如下：

单位：万元

项目	金额	占本次拟投入研发费用的比例
研发材料费用	8,000.00	29.49%
其他研发费用	2,000.00	7.37%
合计	<b>10,000.00</b>	<b>36.86%</b>

2021年度至2023年度公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度	平均占比
研发费用	<b>22,824.98</b>	<b>20,575.18</b>	<b>9,503.90</b>	
其中：研发材料费用	5,093.72	6,189.63	1,824.30	24.78%
其他研发费用	1,940.19	1,239.26	831.61	7.58%

由上可见，本项目研发材料费用、其他研发费用占拟投入的研发费用比例与公司历史研发费用结构基本相当，符合公司实际情况，具有合理性。

### 3、总部基地及研发中心升级建设项目

本项目计划投资总额 67,097.43 万元，其中拟投入募集资金 62,000.00 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	2,980.00	4.44%	-	-
2	建筑投资	39,116.60	58.30%	39,100.00	63.06%
3	设备及软件投资	2,900.00	4.32%	2,900.00	4.68%
4	预备费	2,100.83	3.13%	-	-
5	研发费用	20,000.00	29.81%	20,000.00	32.26%
<b>合计</b>		<b>67,097.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### (1) 土地投资

本项目土地投资为 2,980.00 万元，根据公司与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订的《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（深地合字（2023）4002号），土地使用权出让价款为 2,980.00 万元，该部分投资款公司已通过自有或自筹资金解决。

#### (2) 建筑投资

本项目建筑投资费用主要由建筑工程费用和工程建设其他费用组成，具体构成如下：

单位：万元

序号	具体项目	金额	占比
1	建筑工程费用	37,627.84	96.19%
2	工程建设其他费用	1,488.76	3.81%
合计		<b>39,116.60</b>	<b>100.00%</b>

①建筑工程费用

本项目拟新建公司总部基地及配套设施，具体包括研发洁净车间、研发及行政办公区、配套功能设施等，配套功能设施主要包括公用设备用房、员工公寓、架空绿化等。建筑工程费用根据建筑面积及单位造价确定，具体建筑面积系公司结合总部运营、研发活动所需场地空间，并综合考虑相关人员的办公场所等所需空间确定；单位造价同类项目建设预算情况、市场类似工程相关技术经济指标以及本项目实际建设需求进行合理估算。

本项目建筑工程费用具体测算明细如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	项目	工程量	单位造价	总价
1	研发洁净车间	14,100.00	1.02	14,382.00
2	行政办公区	7,100.00	0.47	3,337.00
3	研发办公区	7,100.00	0.47	3,337.00
4	配套功能设施	12,184.51	0.47	5,726.72
5	地下车库	7,016.00	0.32	2,245.12
6	幕墙施工	-	-	3,500.00
7	机电燃气工程	-	-	5,100.00
合计		<b>47,500.51</b>		<b>37,627.84</b>

注：配套设施主要包括公用设备用房、员工公寓、架空绿化等；地下车库系结合《深圳市城市规划标准与准则》及公司规划等确定

根据《深圳市城市规划标准与准则》等相关规定要求，新型产业项目建设需根据建设面积配建停车场（库）。经深圳市规划和自然资源局龙华管理局批复，本项目需建设配套机动车泊位数不少于 170 辆，并须按相关规定及规范设置充电桩。为了满足上述规定要求，本项目综合利用地下及地上空间建设停车位及配套

充电设施。根据地下实际空间布局及建设条件并经详细规划及测算，地下规划了车库，预计可容纳车位数量为 96 辆，其余车位配置于地上。

同时，本项目配备了相应行政办公区主要系现有办公场地主要采用租赁方式取得，存在办公场所分散，协同及综合管理效率受限的情况。本项目规划办公区可以更好服务于总部及研发中心员工办公需求，实现集约化、系统化运营与管理，更好支撑研发活动，提升研发效率及效益，助力公司整体运营效益提升。

## ②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括工程相关设计费用及咨询费用等，主要系公司综合考虑已签订合同金额、供应商报价、市场公开价格及项目实际情况等因素进行合理估算，具体测算明细如下：

单位：万元

序号	项目	费用总额	测算依据
1	方案设计、施工图、地质勘察、幕墙设计等工程相关设计费用	778.96	公司结合已签订合同金额、供应商报价、市场公开价格及项目实际情况进行合理预估
2	防微振顾问、造价咨询服务、图纸审查等工程相关咨询费用	709.80	
合计		1,488.76	-

本项目包括建筑工程费用和工程建设其他费用在内的建筑投资与上市公司可比项目对比如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

公司名称	项目名称	工程量	工程建设总额	单位造价
中微公司	中微临港总部和研发中心项目	105,000.00	108,000.00	1.03
发行人	总部基地及研发中心升级建设项目	47,500.51	39,116.60	0.82

注：工程建设总额包含工程建筑其他费用

由上可见，本项目单位造价与同行业上市公司可比项目的单位造价不存在显著差异。

综上所述，本项目建筑投资费用的测算具有公允性。

### (3) 设备及软件投资

本项目所需的软硬件设备包含研发相关设备、总部办公设备以及相关软件等，具体构成如下：

单位：万元

序号	具体项目	金额	占比
1	研发相关设备、总部办公设备等硬件设备购置费	2,430.00	83.79%
2	软件购置费	470.00	16.21%
合计		<b>2,900.00</b>	<b>100.00%</b>

其中，单项设备采购总金额超过 200 万元的软硬件设备具体情况如下：

单位：台/套、万元

序号	名称	数量	单价	预算金额	测算参考依据
1	已申请豁免披露	已申请豁免披露	已申请豁免披露	300.00	参考公司同类或相似设备历史采购价格进行合理估算
2				240.00	
3				200.00	
4				200.00	
合计				<b>940.00</b>	-
占比				<b>32.41%</b>	-

本项目设备及软件采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有研发设备情况等因素进行合理估算，采购价格主要系根据公司同类或类似设备历史采购价格、供应商市场报价等因素进行合理估算，具有公允性。

### (4) 研发费用

项目研发费用为建设期内开展相关设备研发所需研发人员薪酬、研发材料费以及其他研发费用等，共计 20,000.00 万元。

#### ①研发人员薪酬

本项目研发人员薪酬为 12,480.00 万元，主要由研发人员数量及人均薪酬构成。研发人员数量主要系根据研发规划预估研发投入人员数量，本项目拟投入研发人

员 244 人。研发人员薪酬主要系根据公司历史研发人员薪酬水平、项目所在地区人均薪酬水平等因素进行合理估算。本项目研发人员人均薪酬为 46.22 万元/年，2021 年度至 2023 年度公司研发人员人均薪酬为 46.10 万元/年，本项目研发人员人均薪酬与公司历史年度水平基本相当，具有公允性。

## ②研发材料费用及其他研发费用

本项目研发材料费用、其他研发费用（差旅费、技术服务费、知识产权相关费等）主要系综合考虑公司历史研发费用结构、研发项目实际需要进行合理估算，具体明细如下：

单位：万元

项目	金额	占本次拟投入研发费用的比例
研发材料费用	6,500.00	32.50%
其他研发费用	1,020.00	5.10%
<b>合计</b>	<b>7,520.00</b>	<b>37.60%</b>

2021 年度至 2023 年度公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度	平均占比
<b>研发费用</b>	<b>22,824.98</b>	<b>20,575.18</b>	<b>9,503.90</b>	
其中：研发材料费用	5,093.72	6,189.63	1,824.30	24.78%
其他研发费用	1,940.19	1,239.26	831.61	7.58%

由上可见，本项目研发材料费用、其他研发费用占拟投入的研发费用比例与公司历史研发费用结构基本相当，符合公司实际情况，具有公允性。

**（二）结合“轻资产、高研发投入”的相关指标要求，说明本次募投非资本性支出占比情况，非资本性支出超过募集资金总额 30% 的部分是否用于主营业务相关的研发投入**

### 1、“轻资产、高研发投入”的相关指标要求

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条相关规定，“上市公司通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，

可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。”

《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（以下简称“《6 号指引》”）中对于“轻资产、高研发投入”的认定标准如下：

项目	具体要求
《6 号指引》第三条	公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于 20%的，可以认定为具有轻资产特点
《6 号指引》第四条	公司同时符合下列指标的，可以认定为具有高研发投入特点： （一）最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于 15%或者最近三年累计研发投入不低于 3 亿元； （二）最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%。

## 2、公司符合《证券期货法律适用意见第 18 号》及《6 号指引》对“轻资产、高研发投入”的相关要求

### （1）公司具有轻资产的特点

截至 2024 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重情况如下所示：

单位：万元

项目	金额	占总资产的比例
固定资产	20,771.00	4.94%
在建工程	29,639.23	7.04%
土地使用权	4,798.97	1.14%
使用权资产	9,000.31	2.14%
长期待摊费用	3,896.40	0.93%
合计	68,105.91	16.19%

截至 2024 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期

待摊费用等合计占总资产比重符合《6号指引》中第三条规定的“轻资产”认定标准，即“公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于20%”。

(2) 公司具有高研发投入的特点

2022年度至2024年度，公司研发投入占营业收入比重情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度	平均值
研发投入	49,796.89	22,824.98	20,575.18	31,065.68
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53	92,683.81
研发投入占营业收入的比例	36.07%	25.62%	40.40%	33.52%

由上可见，2022年度至2024年度，公司最近三年平均研发投入占营业收入比例超过30%。同时，截至2024年末，公司研发人员共478人，占公司当年员工总数的比例超过40%。报告期内，公司研发投入及研发人员情况符合《6号指引》第四条规定的“高研发投入”认定标准，即“最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于15%，且最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于10%”。

因此，公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业。

### 3、本次募投非资本性支出占比情况

本次募投项目的资本性支出及非资本性支出的具体构成如下所示：

单位：万元

项目名称	投资构成	项目投资金额	使用募集资金投入金额	是否属于资本性支出
上海高端半导体质量控制设备产业化项目	土地投资	3,257.66	3,200.00	是
	建筑投资	65,501.63	65,500.00	是
	设备及软件投资	4,741.96	4,700.00	是
	预备费	3,512.18	-	否
	铺底流动资金	7,559.54	-	否

项目名称	投资构成	项目投资金额	使用募集资金投入金额	是否属于资本性支出	
	小计	<b>84,572.97</b>	<b>73,400.00</b>	/	
上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	土地投资	1,574.44	1,500.00	是	
	建筑投资	22,901.09	22,900.00	是	
	设备及软件投资	10,252.14	10,200.00	是	
	预备费	1,657.66	-	否	
	研发费用	27,131.00	10,000.00	否	
	小计	<b>63,516.33</b>	<b>44,600.00</b>	/	
总部基地及研发中心升级建设项目	土地投资	2,980.00	-	是	
	建筑投资	39,116.60	39,100.00	是	
	设备及软件投资	2,900.00	2,900.00	是	
	预备费	2,100.83	-	否	
	研发费用	20,000.00	20,000.00	否	
	小计	<b>67,097.43</b>	<b>62,000.00</b>	/	
补充流动资金		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	否	
合计		<b>285,186.73</b>	<b>250,000.00</b>		
募投项目合计	资本性支出	<b>153,225.52</b>	<b>150,000.00</b>	是	
	非资本性支出	<b>131,961.21</b>	<b>100,000.00</b>	否	
	其中：补充流动资金			70,000.00	/
	研发投入			30,000.00	/
	合计	<b>285,186.73</b>	<b>250,000.00</b>	/	

由上可见，公司本次募投项目中非资本性支出为 100,000.00 万元，占本次发行拟使用募集资金投资总额的 40%，其中，补充流动资金 70,000.00 万元，研发投入 30,000.00 万元。本次募投非资本性支出超出募集资金总金额 30% 的比例为 10%（即 25,000.00 万元），非资本性支出超出募集资金总金额 30% 的部分均会被用于主营业务相关的研发投入，主要研发内容如下表格所示：

募投项目名称	主要研发项目及目标
上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目	(1) 主要开展面向前沿工艺节点的光学关键尺寸量测设备及其零部件研发，产品性能与关键技术指标实现代际提升； (2) 主要开展面向前沿工艺节点的介质薄膜膜厚度量测设备及其零部件研发，产品性能与关键技术指标实现代际提升； (3) 主要开展良率管理系统软件产品的持续升级优化，增加多模态分析、大模型知识库及决策推演模块、全工艺良率预测模块等功能模块，提升软件性能
总部基地及研发中心升级建设项目	(1) 主要开展面向前沿工艺节点的无图形晶圆缺陷检测设备和图形晶圆缺陷检测设备研发；前沿工艺节点的明场纳米图形晶圆缺陷检测设备和暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备等产品研发，产品性能与关键技术指标实现代际提升； (2) 主要开展面向前沿工艺节点及 HBM 应用的三维形貌量测设备、前沿工艺节点的套刻精度量测设备、前沿工艺节点的光学关键尺寸量测设备等产品研发，产品性能与关键技术指标实现代际提升；主要开展面向前沿工艺节点的电子束关键尺寸量测设备产品研发，持续提高产品技术指标

综上所述，公司为具有轻资产、高研发投入特点的企业，本次募投项目非资本性投入的比例超过 30%，超过部分将用于主营业务相关的研发投入，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》及《6 号指引》相关规定要求。

### (三) 结合公司持有货币资金、交易性金融资产及大额存单情况、资金缺口、资产负债率等指标，说明公司本次融资规模的合理性

#### 1、公司持有的货币资金、交易性金融资产及大额存单、资产负债率情况

报告期各期末，公司货币资金、交易性金融资产及大额存单、资产负债率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	62,710.81	58,736.14	24,028.69
交易性金融资产	-	68,845.25	-
大额存单	38,556.43	30,526.38	-
资产负债率	42.07%	29.67%	65.70%

报告期内，公司货币资金主要为银行存款（含前次募集资金）及其他货币资金（主要为履约保函信用证保证金及银行承兑汇票保证金等）；交易性金融资产

主要为银行结构性存款等理财产品；大额存单主要为公司购买的一年以上的可交易大额存单及计提的利息。

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 65.70%、29.67%和 42.07%，其中，2023 年末，公司资产负债率有所下降主要系首次公开发行募集资金到位后，资产负债率有所下降；2024 年末，随着业务不断扩张，公司资产负债率有所增加。

## 2、公司资金缺口情况

综合考虑公司可自由支配资金余额、未来三年预计经营性现金流入净额及各项资金需求安排等，公司未来三年总体资金缺口的具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
截至 2024 年 12 月 31 日货币资金、交易性金融资产及大额存单余额	①	101,267.24
其中：受限制的货币资金余额	②	5,266.75
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金余额	③	45,687.44
可自由支配资金余额	④=①-②-③	50,313.05
未来三年预计经营性现金流入净额	⑤	2,238.18
最低现金保有量需求	⑥	49,332.53
未来三年新增最低现金保有量	⑦	117,164.75
未来三年偿还有息负债利息所需资金	⑧	1,233.46
未来三年预计现金分红所需资金	⑨	9,835.20
已审议的重大投资项目需求	⑩	215,186.74
未来期间总体资金需求合计	⑪=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩	392,752.67
总体资金缺口	⑫=⑪-④-⑤	340,201.44

注：最近一个完整年度财务数据作为测算基础可以更完整呈现公司资金缺口情况，本处测算资金缺口选择以 2024 年 12 月 31 日作为基准日进行，未来三年指 2025 年至 2027 年，下同。

### （1）可自由支配资金余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司货币资金、交易性金融资产及大额存单（含在“其他债权投资”和“一年内到期的非流动资产”中核算的大额存单）合计余额为 101,267.24 万元。其中，受限资金（如保证金等）5,266.75 万元，前次募集

未使用资金 **45,687.44** 万元，据此测算，公司可自由支配的资金余额为 **50,313.05** 万元。

## （2）未来三年预计经营性现金流入净额

公司以报告期内财务数据为基础，综合考虑历史上销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金分别与营业收入、营业成本的关系，采用直接法对未来期间经营性现金流入净额进行测算。

### ①营业收入与营业成本预计

**2022 年度至 2024 年度**，公司营业收入的复合增长率为 **64.64%**，基于谨慎性原则，假设未来三年公司营业收入逐年增长 50%及维持与 **2024 年度** 毛利率相当的盈利水平，据此测算未来三年的营业收入和营业成本情况。

### ②经营活动现金流入预计

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金总额占营业收入总额比例为 **117.22%**，假设未来三年该比例保持在 **115.00%**；报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金总额占营业收入总额比例为 **19.86%**，假设未来三年该比例保持在 **20.00%**。

### ③经营活动现金流出预计

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金总额占营业成本总额比例为 **171.38%**，假设未来三年该比例保持在 **170.00%**。报告期内，公司支付的各项税费总额占营业收入总额的比例为 **3.10%**，假设未来三年该比例保持在 **3.00%**；报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金总额占营业收入总额的比例为 **20.39%**，假设未来三年该比例保持在 **20.00%**。假设公司支付给职工以及为职工支付的现金在 **2024 年度** 的基础上保持每年 20% 的增长。

基于以上假设及预估的财务数据测算的未来三年公司经营活动现金流入净额合计约为 **2,238.18 万元**。

## （3）最低现金保有量

最低现金保有量系公司为维持其日常营运所需要的最低货币资金金额，以应对客户回款不及时，支付供应商货款、员工薪酬、税费等短期付现成本。结合公司经营管理经验、现金收支以及未来三年公司扩张计划等，假设最低现金保有量为公司三个月经营活动现金流出资金。2024年，公司月均经营活动现金流出为**16,444.18万元**，据此测算，公司最低现金保有量为**49,332.53万元**。

(4) 未来三年新增最低现金保有量

公司最低现金保有量与公司经营规模高度相关。假设公司未来三年营业收入按照50%的速度增长，未来三年最低现金保有量在报告期末的基础上按同比例增长，据此计算的**未来三年新增最低现金保有量为117,164.75万元**。

单位：万元

项目	计算公式	计算结果
最低现金保有量	①	<b>49,332.53</b>
营业收入假设增长率	②	<b>50.00%</b>
未来三年末最低现金保有量	③=①*(100%+②)^3	<b>166,497.28</b>
未来三年新增最低现金保有量	④=③-①	<b>117,164.75</b>

(5) 未来三年偿还有息负债利息所需资金

公司**2024年末**的短期借款利率为**1.75%**，假设未来三年短期借款利率维持在**2.00%**；公司**2024年末**的长期借款平均利率为**2.61%**，假设未来三年长期借款利率维持在**3.00%**。假设公司未来三年有息债务（含短期借款及长期借款）的规模不变，未来三年偿还有息债务的利息情况如下：

单位：万元

项目	计算公式	计算结果
短期借款金额	①	<b>927.99</b>
短期借款利率	②	<b>2.00%</b>
短期借款利息	③=①*②*3	<b>55.68</b>
长期借款	④	<b>13,086.40</b>
长期借款利率	⑤	<b>3.00%</b>

项目	计算公式	计算结果
长期借款利息	⑥=④*⑤*3	1,177.78
合计	⑦=③+⑥	1,233.46

公司未来三年偿还有息债务的利息金额合计为 **1,233.46 万元**。

#### (6) 未来三年预计现金分红所需资金

根据经营业绩测算以及《公司章程》涉及的分红比例的相关情况，公司未来三年预计现金分红所需金额为 **9,835.20 万元**。

#### (7) 已审议的重大投资项目需求

截至本回复出具日，公司当前已经董事会审议的重大投资项目需求为本次募集资金投资项目。仅考虑项目建设投资，本次募投项目所需总投资金额为 215,186.74 万元，分别为上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目拟投资 148,089.31 万元和总部基地及研发中心升级建设项目拟投资 67,097.43 万元。

因此，**综合考虑上述因素**，公司面临的资金缺口金额为 **340,201.44 万元**，超过本次募集资金总额 250,000.00 万元，本次募集资金规模具有合理性。

综上所述，基于公司现有资金缺口情况与资产负债结构，公司实施本次融资有利于进一步优化资产负债结构，满足经营性资金需求，提升经营稳定性与核心竞争力，公司本次融资规模具有合理性。

### **(四) “上海高端半导体质量控制设备产业化项目”的销售单价、销量、毛利率等关键指标的测算依据，本次募投项目效益测算的谨慎性及合理性**

上海高端半导体质量控制设备产业化项目税后内部收益率 13.57%，税后投资回收期为 8.40 年（含建设期），效益测算中关键指标测算依据及过程如下：

#### **1、产品销售单价**

本项目投产产品包括半导体检测和量测两大产品类别，具体涉及 9 大细分产品类型系列。公司本次募投项目投产产品预测单价主要系根据公司同类或类似产品销售单价及订单价格、竞品价格、下游市场客户需求等因素进行合理估算。

本项目投产产品具体定价及测算依据情况如下：

单位：万元

序号	产品系列	销售单价	现有产品 售价区间	测算依据
1	无图形晶圆缺陷检测设备系列	已申请豁免 披露	已申请豁免 披露	结合同系列产品在手或意向订单价格进行合理预估
2	图形晶圆缺陷检测设备系列			
3	明场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列			结合竞品价格、同系列产品在手或意向订单价格进行合理预估
4	暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列			
5	三维形貌量测设备系列			结合同系列产品在手或意向订单价格进行合理预估
6	套刻精度量测设备系列			
7	介质薄膜膜厚量测设备系列			
8	金属薄膜量测设备系列			
9	光学关键尺寸量测设备系列			

公司产品销售价格受到国际竞品价格、产品配置成本、产品销售策略、客户批量采购及商务谈判等多种因素影响，在一定范围内存在波动。本次募投项目投产产品销售单价与现有销售价格区间**基本相当**，具有谨慎性及合理性。

## 2、产品销量

本项目产品销量系公司综合考虑下游市场需求、市场发展趋势、自身实际经营情况等因素进行合理估算，预计 T+5 年达产，达产后产品销量情况具体如下：

单位：台

产品	主要内容	达产销量
检测设备	无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、明场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列等	43
量测设备	三维形貌量测设备系列、套刻精度量测设备系列、介质薄膜膜厚量测设备系列、金属薄膜量测设备系列、光学关键尺寸量测设备系列等	35
合计		78

## 3、毛利率测算

项目营业成本包括直接材料、直接人工、折旧摊销费用以及其他制造费用等。

直接材料成本主要系综合考虑公司既往生产情况及本次募投项目实际情况合理估算，直接人工成本主要系综合考虑项目规模所需生产相关人员数量、公司历史薪酬水平及项目所在地区薪酬水平合理估算，折旧摊销费用依据公司会计政策和本项目资产投入情况进行合理估算，其他制造费用主要系综合考虑公司既往生产情况及本项目实际情况等因素合理估算，具有谨慎性和合理性。

本项目通过营业收入和营业成本的差值计算本项目测算期内的毛利，项目达产期（指计算期第 5 年至第 10 年，下同）平均毛利率为 46.41%，与公司最近三年毛利率对比情况如下：

项目	本次募投项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
毛利率	46.41%	47.77%	44.78%	44.20%

注：本项目毛利率按《企业会计准则应用指南汇编（2024）》对保证类质保费用的列示进行重述后结果

报告期内，公司本项目毛利率处于公司最近 3 年公司毛利率区间内，低于 2023 年度，与公司历史年度毛利率不存在显著差异，具有谨慎性和合理性。

#### 4、项目总体效益情况

上海高端半导体质量控制设备产业化项目整体效益情况如下：

项目	单位	数值
内部收益率（IRR）税前	-	15.84%
内部收益率（IRR）税后	-	13.57%
净现值（NPV）税后	万元	5,900.74
回收期（税后）（含建设期）	年	8.40
达产后年均收入（不含税）	万元	83,488.32
达产后年均净利润	万元	13,443.54

本项目预计效益与同行业可比公司比较情况如下：

公司名称	项目名称	毛利率	净利率	税后内部收益率	税后投资回收期（年）
中微公司	中微临港产业化基地	39.64%	未披露	11.83%	10.00

公司名称	项目名称	毛利率	净利率	税后内部收益率	税后投资回收期（年）
	中微南昌产业化基地			10.25%	11.12
芯源微	上海临港研发及产业化项目	43.09%	18.93%	15.76%	7.83
发行人	本项目	46.41%	16.10%	13.57%	8.40

由上可见，本项目效益指标税后内部收益率、税后投资回收期与同行业公司不存在显著差异情况，处于合理区间内，具有谨慎性和合理性。

## 二、申报会计师核查意见

### （一）核查程序

针对上述事项，申报会计师主要执行了以下核查程序：

1、查阅本次募投项目的可行性研究报告，了解本次募投项目的各项投资支出的具体构成、测算过程及测算依据，了解本次募投项目效益测算关键指标的测算依据，查阅公司同类项目及上市公司可比项目情况并进行比较分析；

2、查阅发行人本次募投项目的投资明细表，核查项目具体投资构成和金额明细，复核本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及占比情况；结合《证券期货法律适用意见第18号》第五条、《6号指引》的相关规定，核查本次募投项目是否符合监管要求；

3、查阅发行人报告期内主要财务数据、截至报告期期末的货币资金余额和交易性金融资产余额，测算未来三年预计经营性现金流入净额、最低现金保有量、未来三年预计现金分红所需资金、未来三年营运资金缺口等，分析发行人本次募集资金用于补充流动资金的规模的合理性；

4、访谈公司管理层，了解发行人未来货币资金余额的使用计划，了解本次融资的必要性及规模的合理性等情况；了解本次募投项目效益测算关键指标测算依据、测算具体过程，分析本次募投项目效益测算的谨慎性及合理性。

### （二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、公司本次募投项目各项投资支出的相关测算依据和测算过程合理，具有公允性；

2、发行人本次募集资金符合《证券期货法律适用意见第 18 号》、《6 号指引》的相关要求，本次募投非资本性支出超过募集资金总额 30%的部分均会被用于主营业务相关的研发投入；

3、发行人本次融资规模系综合考虑公司现用货币资金用途、资金缺口情况及资产负债结构等因素后的结果，具有合理性；

4、发行人“上海高端半导体质量控制设备产业化项目”的销售单价、销量、毛利率等关键指标的测算情况及依据系公司综合自身经营情况、项目具体情况及未来经营发展规划、市场类似项目情况、行业发展趋势等确定的，本次募投项目效益测算具有谨慎性及合理性。

#### 4、关于经营情况

根据申报材料：（1）2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 36,055.34 万元、50,923.53 万元、89,090.01 万元、81,242.94 万元；（2）报告期各期，公司综合毛利率分别为 48.96%、48.67%、52.62%、47.69%，期间费用合计分别为 16,289.23 万元、31,911.65 万元、41,006.34 万元、50,759.24 万元，扣非后归母净利润分别为 348.01 万元、-8,785.13 万元、3,169.30 万元、-12,539.52 万元；

（3）根据业绩预告，公司预计 2024 年度扣非后归母净利润-14,500.00 万元到-9,500.00 万元，

请发行人说明：（1）报告期内主要客户的复购情况、报告期各期新增主要客户的情况，说明公司营业收入增长的原因及持续性；（2）结合公司产品结构、下游需求、技术水平、同行业毛利率等情况，说明报告期内公司产品毛利率与同行业可比公司平均水平的差异原因；（3）结合报告期内公司毛利变动、各类期间费用增加原因及与收入规模增加的匹配性等因素，说明报告期内公司扣非后归母净利润波动较大的原因及合理性，相关因素对公司业绩波动的具体影响；（4）报告期各期，公司经营活动现金流量净额与净利润的差异及原因。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

**【回复】**

**一、发行人说明**

**（一）报告期内主要客户的复购情况、报告期各期新增主要客户的情况，说明公司营业收入增长的原因及持续性**

**1、报告期内主要客户情况**

报告期各期，公司前五大客户情况如下表所示：

期间	前五大客户	前五大客户收入占比
2024 年度	已申请豁免披露	39.31%
2023 年度		27.32%
2022 年度		33.27%

注：同一实际控制人控制的企业合并计算口径

由上可见，报告期内，公司前五大客户均为半导体领域知名客户，公司前五大客户比较分散，不存在单一客户占公司收入 50%以上情况。

**（1）报告期内主要客户的复购情况**

报告期内，各期前五大客户的复购情况如下表所示：

序号	客户名称	采购情况		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
1	已申请豁免披露	是	是	是
2		是	是	是
3		是		
4		是	是	是
5		是	是	是
6		是	是	是
7		是	是	是
8		是	是	是

序号	客户名称	采购情况		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
9		是	是	
10		是	是	是
11		是		是
12		是	是	是

由上可见，报告期内，公司主要客户均存在持续向公司采购的情况，采购节奏主要受其自身经营计划和预算等因素影响。公司客户采购公司产品类型和数量存在一定波动的情况，有其商业合理性，不存在重大异常情况。

## （2）报告期各期新增主要客户的情况

报告期各期，公司新增前五大客户的情况已申请豁免披露。

自设立以来，公司专注于高端半导体质量控制领域，致力于为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品及配套服务的全流程良率管理解决方案。受益于公司产品完整的战略布局，以及在核心技术上的持续研发突破、在产品迭代升级上的快速推进等方面的综合推动下，公司得以紧跟客户的工艺发展需求，为不同类型的集成电路客户提供不同的产品组合和服务。

报告期各期，公司新增前五大客户主要涉及逻辑、存储、功率半导体等前道制程企业，晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业等。报告期内，客户采购频次及采购规模主要受其自身经营计划和预算等因素影响，公司前五大客户存在一定变动，但均与公司保持良好的合作关系，客户群体类型未发生重大变化。

## 2、公司营业收入增长的原因及持续性

### （1）公司营业收入增长受多种因素的积极影响

报告期内，公司营业收入及增长情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53
同比增长率	54.94%	74.95%	41.24%

报告期内，公司营业收入快速增长，主要系多种因素的积极影响，具体如下：

①半导体产业的迅速发展，为公司提供了良好的发展环境与机遇

半导体设备市场规模主要受下游市场需求驱动，与半导体产业景气状况紧密相关。随着全球物联网、5G 通信、汽车电子等新型应用市场的不断发展产生了巨大的半导体产品需求，推动半导体行业进入新一轮的发展周期。全球范围内，晶圆厂产能扩张仍在继续，下游需求的不断发展为半导体设备制造产业的扩张和升级提供了机遇。

目前中国成为全球最大的集成电路生产和消费国。近年来，在全球供应链紧张和国家政策资金大力扶持的背景下，我国晶圆代工、封装测试行业主要企业都有不同规模的产能扩张和升级计划，为国内设备厂商带来巨大的发展机遇。根据 SEMI 数据，2020 年度至 2023 年度，中国大陆半导体设备市场销售额分别为 187.2 亿美元、296.0 亿美元、282.7 亿美元和 366.6 亿美元，**2024 年度销售额预计达到 490.0 亿美元**，已连续**五年**成为全球第一大半导体设备市场。随着下游客户新建和扩建产能计划的逐步实施、国产化进程的进一步提升，国产半导体设备将迎来快速发展期。中国半导体产业的快速发展为公司提供了良好的发展环境与机遇。

②掌握关键核心技术以及持续自主创新，进一步巩固并提升公司竞争优势

公司始终坚持创新及差异化发展战略，在检测和量测设备的研发中，公司攻克了多项设备关键模块自主化开发难题，技术创新能力得到显著提升；在智能软件产品研发中，公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品。目前，公司已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等多项核心技术，上述核心技术成功应用于公司各系列产品，为公司创造了良好的经济效益。截至报告期末，公司拥有专利超过 **600** 项，其中发明专利超过 **100**

项，并承担了国家级、省级、市级重点专项研发任务，具备可持续的研发创新能力，在行业竞争中拥有较强的技术优势。

③优质的客户群体及日趋丰富的产品线，为公司发展提供了持续动力

公司凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务等积极因素，品牌认可度不断提升，客户群体覆盖度进一步扩大，客户订单量持续增长。公司客户群体已广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等各类制程设备企业。截至 2024 年 12 月末，公司累计客户数量超过 200 家，在手订单已申请豁免披露。

作为国内半导体质量控制设备领域的先行者，公司能够为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和服务的全流程良率管理解决方案。公司九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求。其中，**七大系列设备已经批量量产并在国内头部客户产线应用**，技术指标全面满足国内主流客户工艺需求，公司各系列产品市占率稳步快速增长；另外**两大系列设备已完成样机研发并批量出货至多家国内头部客户开展产线工艺验证和应用开发**；三大系列智能软件已全部应用在国内头部客户。公司优质的客户群体及日趋丰富的产品线，为公司发展提供了持续动力。

(2) 公司营业收入增长具备持续性

未来，公司营业收入将迎来持续增长，主要背景如下：

从下游需求来看，随着全球物联网、5G 通信、汽车电子等新型应用市场的不断发展，半导体应用和消费市场需求未来将保持稳定增长，根据 WSTS 数据，预计 2025 年全球半导体市场将同比增长 11.2%达到 6,972 亿美元。全球半导体需求的持续增长将进一步带动半导体设备市场规模的持续扩张，**根据 SEMI 预测，2025 年半导体制造设备全球总销售额将达到 1,210 亿美元，预计增长率达 7%**。同时，国内晶圆代工、封装测试行业主要企业产能加速扩张，半导体设备国产化进程的进一步提升，均为本土设备厂商提供巨大机遇，公司作为高端半导体质量控制领

域领军企业将充分受益。

从技术水平来看，公司掌握关键核心技术以及持续自主创新，在行业竞争中拥有较强的技术优势。2022 年度至 2024 年度，公司研发投入分别为 20,575.18 万元、22,824.98 万元和 49,796.89 万元，公司持续加大新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入，巩固和提升公司核心技术实力，现已形成多项关键核心技术并成功应用于公司各系列产品。公司未来将持续加大研发投入，在核心技术上持续研发突破，保障技术优势地位，推动收入持续增长。

从客户群体和产品布局来看，受益于公司在设备和软件产品组合上的完整战略布局，以及在核心技术上的持续研发突破、在产品迭代升级上的快速推进，在客户服务上的全面覆盖和品牌口碑上的快速提升等方面的综合推动下，公司得以紧跟客户的工艺发展需求，为不同类型的集成电路客户提供不同的产品组合和服务。公司客户群体已广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等各类制程设备企业。公司为上述客户提供的产品组合包括了全部种类的光学检测和量测设备以及软件。同时，公司持有在手订单充足，能充分支撑后续业绩的持续释放。

综上所述，公司营业收入增长具备持续性。

## **（二）结合公司产品结构、下游需求、技术水平、同行业毛利率等情况，说明报告期内公司产品毛利率与同行业可比公司平均水平的差异原因**

公司同行业企业主要包括科磊半导体、应用材料、创新科技、上海睿励、上海精测等。其中，科磊半导体、应用材料、创新科技等企业业务体系较为多元，体量规模与发行人差异较大，上海睿励、上海精测等为非上市公司或上市公司子公司公开披露信息较少，故发行人综合考虑产品特性、客户类型等方面因素，选取中微公司、芯源微、盛美上海、华海清科、华峰测控等上市企业作为同行业可比公司。

报告期内，公司与可比公司的综合毛利率对比情况如下：

公司名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
盛美上海	48.86%	50.69%	48.90%
中微公司	未披露	45.83%	45.74%
芯源微	未披露	42.53%	38.40%
华海清科	未披露	46.02%	47.72%
华峰测控	73.31%	71.19%	76.88%
可比公司平均值	61.09%	51.25%	51.53%
中科飞测	48.90%	47.77%	48.67%

注 1：上述数据取自可比公司各年年报；

注 2：2023 年度和 2024 年，公司根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定将保证类质保费用计入营业成本；上表中公司、盛美上海和华峰测控 2023 年毛利率均为追溯后毛利率，其他公司未见披露相关数据

由上可见，报告期内，公司毛利率水平处于同行业可比上市公司合理区间内，与同行业可比公司平均水平不存在显著异常情况。报告期内，公司综合毛利率与盛美上海基本相当，略高于华海清科、中微公司、芯源微，低于华峰测控。公司毛利率与同行业可比的毛利率存在一定差异，具体情况如下：

### 1、公司毛利率与同行业可比公司的差异主要系受主营产品不同的影响

半导体设备根据其工艺类型可分为光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、质量控制设备、清洗设备、CMP 设备等。公司主要产品为高端半导体质量控制设备，与同行业可比公司的主要产品比较情况如下：

公司名称	业务与产品差异	业务与产品共性
盛美上海	主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等	公司与同行业可比公司主要产品均为半导体设备
中微公司	主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，向下游集成电路、LED 外延片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备和 MOCVD 设备、提供配件及服务	
芯源微	主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备	
华海清科	主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，向下游集成电路制造商及科研院所等客户销售 CMP、减薄、划切、清洗等半导体装备，并提供关键耗材与维保、升级等技术服务和晶圆再生业务。	

公司名称	业务与产品差异	业务与产品共性
华峰测控	主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售,主要产品为半导体自动化测试系统及测试系统配件,用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数,判断芯片在不同工作条件下功能和性能的有效性	
中科飞测	专注于高端半导体质量控制领域,致力于为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和服务的全流程良率管理解决方案,覆盖九大系列设备和三大系列软件产品	

由上可见,公司主营产品与同行业产品存在明显的差异。不同半导体设备在产品主要用途、应用的核心技术、所处竞争环境等存在一定差异,从而导致不同细分领域半导体设备企业毛利率存在一定差异。主营产品不同对综合毛利率水平具有直接影响。报告期内,同行业可比公司因产品不同其综合毛利率从 30%至 80%不等,不尽相同,存在一定差异。

## 2、公司毛利率水平受下游需求、技术水平以及所属细分行业毛利率等综合影响

半导体质量控制设备旺盛的下游需求及公司较强的技术优势为公司的毛利率水平提供了有力支撑。一方面,得益于中国半导体全行业的蓬勃发展和国家对半导体产业持续的政策扶持,行业下游晶圆厂在关键工艺节点上实现持续推进,多家国内领先的半导体制造企业进入产能扩张期,中国大陆半导体检测与量测设备的市场处于高速发展期。而目前国内市场被国外厂商垄断,受全球供应链的紧张和国际贸易摩擦影响,半导体检测与量测设备的国产化替代需求强劲。公司作为国内领先的端半导体质量控制设备厂商,凭借多年在半导体检测和量测领域的开发经验,积累了多家集成电路前道制程、先进封装等领域的知名客户,下游需求旺盛。另一方面,公司坚持创新及差异化发展战略,凭借优秀的技术研发团队、较强的技术创新能力以及多年技术积累,已经在高端半导体质量控制领域形成了强大的技术实力及储备。截至报告期末,公司已拥有授权专利超过 600 项,其中发明专利超过 100 项;公司亦牵头承担了多个国家级、省级、市级重点专项研发任务,参与了多项国家及国际标准的制定,在行业竞争中拥有较强的技术优势。

同时，半导体质量控制设备在半导体设备企业领域中具有较高的毛利率水平。根据科磊半导体财务数据显示，2022 年度、2023 年度及 **2024 年度**，科磊半导体的毛利率分别为 61.00%、59.81%和 **59.97%**，处于行业较高水平。报告期内，公司虽已推出多个系列半导体质量控制设备，并通过国内众多知名客户验证，盈利能力持续改善，但与科磊半导体等国外企业相比，公司产品毛利率水平亦存在一定差距。

### 3、报告期内公司毛利率整体稳定，不存在异常波动情况

报告期内，公司毛利率存在一定波动，略有上升，不存在异常波动情况。公司毛利率 2023 年度相较于前期有一定的下浮主要系受公司根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定将保证类质保费用计入营业成本的会计政策调整的影响。若按照统一口径，2022 年度追溯后的毛利率为 44.78%，报告期内，公司毛利率整体稳定且呈现上升，主要系规模效应带动整体毛利率的提升。

综上所述，报告期内公司毛利率水平受下游旺盛的市场需求、公司技术优势及公司所属行业较高的毛利率水平等综合影响。公司毛利率与同行业可比公司的差异主要系受主营产品不同的影响，不存在重大异常情况。

**（三）结合报告期内公司毛利变动、各类期间费用增加原因及与收入规模增加的匹配性等因素，说明报告期内公司扣非后归母净利润波动较大的原因及合理性，相关因素对公司业绩波动的具体影响**

#### 1、报告期内公司毛利、期间费用以及扣非净利润情况

报告期内，公司主要财务数据相较于同期有一定幅度的波动情况，主要变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53
营业收入同比增长情况	54.94%	74.95%	41.24%
毛利率	48.90%	47.77%	48.67%

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业毛利	67,498.32	42,558.32	24,785.27
期间费用	76,605.28	36,686.08	31,911.65
期间费用同比增长情况	108.81%	14.96%	95.91%
净利润	-1,152.51	14,034.46	1,197.09
非经常性损益金额	11,257.86	10,865.17	9,959.48
扣非后归母净利润	-12,410.37	3,169.30	-8,762.39
股份支付金额	7,814.48	265.89	265.89
剔除股份支付后的扣非后归母净利润	-4,595.89	3,435.19	-8,496.50

注 1：2024 年及 2023 年，公司根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定将保证类质保费用计入营业成本，2024 年及 2023 年毛利率为追溯后；

注 2：2024 年股份支付金额不涉及与生产人员相关的部分。

由上可见，报告期内，公司毛利率水平总体相对稳定，未发生显著变化。在毛利率相对稳定的背景下，公司营业收入及毛利均有所增长，增幅整体基本相当。同期，随着公司业务规模扩大，报告期内各期期间费用呈现相应增长，其中，又以研发费用增长较为显著。在研发规模及股份支付规模相对较大的背景下，研发费用及股份支付的增长部分抵消了营业收入及毛利增长对业绩的影响，导致报告期内公司净利润及扣非后归母净利润有一定波动。

(1) 研发费用对损益的影响情况。报告期内，公司研发费用累计金额为 93,197.05 万元，占期间费用总额 64.18%。公司作为以研发为驱动的半导体设备企业，报告期内公司开展了一系列新产品研发及现有产品升级优化等重点研发项目，主要涉及如下所示：

单位：万元

序号	主要研发项目	报告期内累计投入金额
1	明场纳米图形晶圆缺陷检测设备	23,467.19
2	无图形晶圆缺陷检测设备	12,401.60
3	图形晶圆缺陷检测设备	9,217.22
4	暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备	9,087.38
5	套刻精度量测设备	7,461.02

序号	主要研发项目	报告期内累计投入金额
6	介质薄膜膜厚度量测设备	6,037.46
7	电子束关键尺寸量测设备	3,016.81
8	三维形貌量测设备	4,583.47
合计		75,272.15

受益于公司高水平的研发投入，公司研发取得积极成果，明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备以及光学关键尺寸量测设备等新产品已陆续出货客户开展工艺验证和应用开发。同时，公司专利由 2021 年末的不到 200 项增加至 2024 年末的超过 600 项，其中，发明专利由 44 项增加至 178 项。该等研发成果为公司未来的发展打下坚实基础，将助力公司长期可持续发展。

(2) 股份支付对损益的影响情况。的与此同时，报告期内，公司股权激励涉及的股份支付规模较大，尤其是 2024 年股份支付对报告期内公司净利润及扣非后归母净利润的波动有重大影响。报告期内公司股权支付以及未来三年股份支付的影响如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度
员工持股平台	265.89	265.89	265.89	265.89	265.89	265.89
2024 年股权激励计划首次授予部分	-	-	8,054.92	7,414.33	4,032.89	1,929.26
2024 年股权激励计划预留授予部分	-	-	-	1,606.52	1,296.81	626.12
合计	265.89	265.89	8,320.81	9,286.74	5,595.59	2,821.27

注：上述 2025 年度至 2027 年度结果不代表最终成本，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达标情况会影响最终股份支付数据；上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由上可见，相较于报告期其他各期，公司 2024 年度股份支付增加较大，并将于随后逐步回落，对公司损益影响将逐步减少。

## 2、报告期内公司扣非净利润波动的主要原因

公司扣非后归母净利润波动系净利润和非经常性损益变动的综合影响结果。

报告期内，公司扣非后归母净利润与净利润及非经常性损益的波动情况具体如下所示：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
扣非后归母净利润增减额	-15,579.67	11,931.69	/
其中：净利润增加额	-15,186.97	12,837.37	/
非经常性损益增加额	392.69	905.69	/

注：表格中增加额中若是减少，则以负号表示；

由上可见，公司扣非后归母净利润主要受净利润波动的影响，波动趋势与净利润波动趋势基本一致。报告期内，公司净利润波动与毛利及期间费用具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
净利润增加额	-15,579.67	12,837.37	/
营业毛利增加对净利润影响	24,940.00	17,773.05	/
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53
毛利率	48.90%	47.77%	48.67%
期间费用增加对净利润影响	-39,919.21	-4,774.43	/
其中：销售费用增加额	4,756.51	442.78	/
管理费用增加额	7,411.08	2,846.48	/
研发费用增加额	26,971.91	2,249.80	/
财务费用增加额	779.71	-764.63	/

由上可见，报告期内，公司净利润波动主要受毛利及期间费用的波动影响，其中，期间费用又以研发费用变动为主。

#### （1）毛利波动情况分析

报告期内，公司营业收入规模持续增长，2023 年度及 2024 年度，公司营业收入增长率同比分别为 74.95%及 54.94%。随着公司核心技术的不断突破和产品种类的日趋丰富，以及国产替代需求的快速发展和公司市场认可度的稳步提升等因

素积极影响，公司客户群体和客户订单持续增长，有力推动了公司经营业绩快速增长。

报告期内，依托于公司积累起的技术和产品优势，公司产品保持了较高的盈利水平，生产经营情况持续向好。公司毛利率总体相对稳定，未发生显著的变化。在毛利率相对稳定的背景下，报告期内，公司毛利总体呈现出持续上涨趋势，毛利增幅与营业收入增幅基本相当，不存在异常波动情况。

## （2）期间费用波动情况分析

报告期内，公司期间费用随着公司营业收入规模增长呈现出相应增长，其中，又以研发费用增加为主。与2022年度相比，2023年及2024年，期间费用累计增加44,693.64万元，其中研发费用累计增加29,221.71万元，占比65.38%；管理费用和销售费用随着公司营业收入规模增长呈现出一定幅度增长。具体分析如下：

### ①研发费用波动情况

公司作为以研发为驱动的半导体设备企业，报告期内公司开展了一系列新产品研发及现有产品升级优化研发，研发项目数量及研发人员数量均不断增长，研发投入维持在较高水平。报告期内，公司研发费用主要构成及变动原因如下：

单位：万元

项目	2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	24,300.90	48.80%	13,830.09	60.59%	11,419.52	55.50%
材料费用	10,896.83	21.88%	5,093.72	22.32%	6,189.63	30.08%
技术服务费	5,541.17	11.13%	641.14	2.81%	450.15	2.19%
股份支付费	3,305.38	6.64%	236.64	1.04%	236.64	1.15%
折旧与摊销	2,668.23	5.36%	1,257.28	5.51%	1,025.11	4.98%
交通差旅费	2,090.94	4.20%	1,188.47	5.21%	553.07	2.69%
租赁水电费	675.79	1.36%	305.25	1.34%	322.83	1.57%
知识产权相关费	103.02	0.21%	110.58	0.48%	236.05	1.15%
其他	214.64	0.43%	161.80	0.71%	142.19	0.69%

项目	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	49,796.89	100.00%	22,824.98	100.00%	20,575.18	100.00%

由上可见，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费用、技术服务费以及股份支付费用等构成。

A.报告期内，公司研发费用中职工薪酬费用金额维持在较高水平，总体呈现出上升趋势，主要系半导体设备行业为技术密集型行业，公司竞争力与研发实力密不可分。公司为了增强公司研发实力，持续吸引行业内优秀人才。报告期内，研发费用中职工薪酬增长主要原因系受研发人员数量增长及研发人员人均薪酬增长的影响。报告期各期末，公司研发人员数量分别为324人、378人和**478**人，呈现快速增长。

B.材料费用系研发活动中的直接材料支出，各研发项目根据单独研发订单进行领料及核算。报告期内，公司研发材料占比较高，主要系公司开展了多个设备研发项目，研发项目中涉及的材料费用有所增长导致。

C.技术服务费主要系公司研发过程中与研发活动相关的定制模块或产品的开发。报告期内，公司技术服务费存在一定波动，其中**2024年度**公司技术服务费相较于其他各期有所较大增长主要受公司重点研发项目采购技术服务费用增加所致。

D.报告期内，公司股份支付费用存在一定波动，其中，**2024年度**股份支付金额较大主要系2024年公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》，股份支付费用有所增加。

## ②销售费用波动情况

报告期内，公司销售费用主要构成及变动原因如下：

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,503.87	42.58%	2,942.26	50.55%	2,143.66	39.86%

项目	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股份支付费	1,891.45	17.88%	25.85	0.44%	25.85	0.48%
产品质量保证金	-	-	-	-	1,979.40	36.81%
交通差旅费	1,167.71	11.04%	783.64	13.46%	350.20	6.51%
市场推广费	1,337.97	12.65%	1,229.65	21.13%	370.50	6.89%
业务招待费	583.96	5.52%	384.97	6.61%	199.73	3.71%
折旧与摊销	162.54	1.54%	171.10	2.94%	168.85	3.14%
租赁水电费	67.79	0.64%	67.41	1.16%	45.19	0.84%
运输包装费	137.38	1.30%	59.00	1.01%	46.05	0.86%
其他	724.52	6.85%	156.80	2.69%	48.48	0.90%
合计	10,577.18	100.00%	5,820.68	100.00%	5,377.89	100.00%

由上可见，报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付、交通差旅费以及市场推广费等构成。

A.报告期内，公司销售费用中职工薪酬金额逐年增加，主要原因系随着公司业务快速增长，销售人员数量增加所致，报告期各期末，公司销售及技术支持人员数量分别为 181 人、220 人及 269 人，呈现上升趋势。

B.报告期内，公司股份支付费用存在一定波动，其中，2024 年度股份支付金额较大主要系公司 2024 年制定并实施了《2024 年限制性股票激励计划》，股份支付费用有所增加。

C.报告期内，公司产品质量保证金存在一定波动，主要系质量保证金报表列示存在调整。2022 年度，公司根据合同约定对销售的设备负有质保义务并相应确认产品质量保证金。报告期内，随着公司营业收入的快速增长，相应的产品质量保证金随之增加。2023 年度和 2024 年度，公司根据《企业会计准则解释第 18 号》规定，将产品质量保证金从“销售费用”调整至“营业成本”科目中核算，故产品质量保证金费用金额为 0 元。

D.报告期内，随着公司营业收入的快速增长，销售相关的交通差旅费随之呈

现出一定增长，不存在异常波动情况。

E.报告期内，公司市场推广费主要包括代理商销售佣金、展览费等。报告期前期，公司处于成长阶段，为加快扩大市场规模，公司采取了直接推介、代理商推广、参加行业展会、参与招投标等多种方式推介公司相关产品。随着公司经营规模扩大，报告期内公司市场推广费有所增长，主要系受公司加大市场推广力度，及行业竞争有所增加所致。

### ③管理费用波动情况

报告期内，公司各期管理费用主要构成及变动原因如下：

单位：万元

项目	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	7,358.62	45.25%	4,792.07	54.14%	3,644.03	60.69%
股份支付费	2,617.65	16.10%	3.40	0.04%	3.40	0.06%
折旧与摊销	2,306.59	14.18%	1,590.31	17.97%	1,121.50	18.68%
办公费	1,078.98	6.63%	464.38	5.25%	390.01	6.49%
中介机构服务费	497.89	3.06%	527.85	5.96%	265.29	4.42%
租赁水电费	434.08	2.67%	314.14	3.55%	229.81	3.83%
交通差旅费	245.59	1.51%	180.36	2.04%	84.24	1.40%
业务招待费	51.29	0.32%	398.64	4.50%	27.35	0.46%
其他	1,671.66	10.28%	580.11	6.55%	239.15	3.98%
合计	16,262.34	100.00%	8,851.26	100.00%	6,004.78	100.00%

由上可见，公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销、办公费等构成。

A.报告期内，随着公司业务规模增长，管理人员数量增加及管理人员平均工资上升，进而导致管理费用中的职工薪酬呈现逐年增加情况。

B.报告期内，公司股份支付费用存在一定波动，其中，**2024 年度**股份支付金额较大主要系 2024 年公司制定并实施了《2024 年限制性股票激励计划》，股份支

付费用有所增加。

C.报告期内，折旧与摊销及办公费整体规模有所上升主要系随着公司经营规模持续扩大影响所致，不存在异常波动情况。

综上所述，报告期内公司扣非后归母净利润有所波动主要系受营业毛利、期间费用等综合变动所致，具有合理性。

### 3、前述相关因素对公司业绩波动的具体影响

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存在一定波动，主要系受研发项目投入相对较大以及现阶段公司营业收入规模相对较小，规模效应尚未充分体现等综合因素影响所致。前述研发投入规模较大对盈利情况的影响因素属于短期暂时性因素，对公司生产经营可持续性不构成重大不利影响。**报告期内，公司研发费用占营业收入比例平均为 33.52%，显著高于同行业可比公司 2022 年至 2023 年的平均值 13.27%（2024 年部分可比公司未披露财务数据）。**未来随着重点研发项目及其产业化应用有序推进，公司收入规模将持续扩大，研发投入规模将相对稳定，增幅趋于平稳，研发费用占营业收入比例将趋于行业平均水平，并随规模效应逐步体现期间费用率将有所下降，**加之股份支付的影响金额将逐步减少，公司盈利水平将得到改善。**

同时，公司本次及前次募投项目的实施将会在各自达到预定可使用状态后新增部分折旧与摊销。根据测算，前次募投项目达产后，预计每年新增折旧摊销费用合计约为 2,467.30 万元，本次募投项目 T+5 年达到预计可使用状态后新增折旧摊销费用合计约为 6,158.50 万元，总体规模相对较小，对公司未来经营业绩不构成重大影响。

综上所述，随着公司业绩规模持续增长、研发费用投入占收入比重趋于稳定以及规模经济效应逐步体现，未来公司盈利水平将趋于改善态势，具体盈利规模将主要受收入规模增速、重点研发项目产业化情况以及产品市场拓展等因素的综合影响。

#### （四）报告期各期，公司经营活动现金流量净额与净利润的差异及原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流量的净额与净利润情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
净利润	-1,152.51	14,034.46	1,197.09
经营活动现金流量净额	-31,270.10	-5,203.74	6,701.43
经营活动现金流量净额与净利润的差异	-30,117.58	-19,238.20	5,504.34

由上可见，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的存在一定差异，具体调节关系及差异情况如下所示：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动现金流量净额	-31,270.10	-5,203.74	6,701.43
净利润	-1,152.51	14,034.46	1,197.09
经营活动现金流量净额与净利润的差异	-30,117.58	-19,238.20	5,504.34
其中：			
资产/信用减值损失	5,471.54	2,284.59	1,546.26
长期资产折旧及摊销	7,007.38	4,460.54	3,260.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,942.18	-26,985.06	-33,619.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,018.05	-2,519.77	-13,910.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,642.45	4,068.12	47,710.51
其他	6,721.27	-546.62	539.64
合计	-30,117.58	-19,238.20	5,504.34

由上可见，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系是受存货、经营性应收应付项目的影响，其变动的具体分析如下：

1、公司业绩规模持续快速提升带动存货规模持续增长，进一步导致公司采购支出规模有所增长

报告期内，公司分别实现营业收入 50,923.53 万元、89,090.01 万元及

**138,037.88 万元，复合增长率为 64.64%**。此外，报告期内，公司产品种类不断丰富，原材料种类相应增加。公司业务规模的迅速增长及产品类型的丰富直接带动存货规模快速增长。报告期各期末，公司存货金额分别为 86,133.50 万元、111,198.83 万元及 **174,676.15 万元，复合增长率为 42.11%**，存货规模的持续增长导致报告期内公司采购规模快速增长，进而影响了公司经营活动现金流出规模。

## **2、公司研发投入维持在较高水平，相关现金流出增长较快**

公司作为以研发为驱动的半导体设备企业，研发投入维持在较高水平。**2022 年度至 2024 年度**，公司研发费用分别为 20,575.18 万元、22,824.98 万元及 **49,796.89 万元**，占营业收入的比例分别为 40.40%、25.62%及 **36.07%**。报告期内，公司持续大规模的研发投入有利于产品线进一步丰富，然而，研发投入设备产生规模效益尚需一定时间。大规模研发投入短期内增加了公司经营活动现金流出规模。

## **3、公司产品生产验收周期较长，资金回收过程较长**

报告期内，公司主要根据销售订单及销售预测进行生产。在产品交付过程中，公司产品会涉及生产、发货、安装及验收等流程，整个业务流程周期相对较长，产品销售的资金流入与原材料购买的资金流出存在一定时间间隔。在业务规模快速增长的背景下，公司会存在一定规模的应收账款。随着公司业务规模快速增长，应收账款相应呈现增长趋势。**2022 年至 2024 年度**，公司营业收入复合增长率为 **64.64%**，应收账款复合增长率为 **65.18%**。报告期各期末较大规模的应收账款影响了公司经营活动现金流入规模。

综上所述，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异，与公司生产经营活动实际开展的情况相符，具有合理性。

## **二、申报会计师核查意见**

### **（一）核查程序**

针对上述事项，申报会计师主要执行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层，了解公司主要客户及复购情况，了解公司营业收入增

长的原因及持续性情况，了解公司产品毛利水平的波动原因及合理性并对比分析公司与同行业公司毛利率平均水平差异的原因，了解经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异的原因及合理性；

2、对比报告期内主要客户名单，比较各期新增主要客户情况，分析报告期客户数量变动情况；查阅公开资料，了解公司新增前五大客户的基本情况，包括但不限于成立时间、主营业务、财务规模等；

3、获取发行人报告期内财务报表、各损益科目变动情况等，了解各损益科目变动对扣非后归母净利润的影响，核查并分析期间费用、非经常性损益等科目明细变动的原因及合理性；

4、获取发行人报告期内现金流量表，结合影响经营现金流的应收、应付、存货等主要项目的变化情况，分析经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异的原因及合理性。

## **（二）核查结论**

经核查，申报会计师认为：

1、报告期内，公司主要客户存在持续向公司采购的情况。报告期内，公司营业收入快速增长，主要系受半导体产业良好的发展环境、公司掌握自主核心技术以及拥有丰富的产品线及优质客户群等因素的综合影响。目前，公司已经掌握关键核心技术并坚持持续创新，并拥有优质的客户群体及日趋丰富的产品线，受该等积极因素影响，公司营业收入增长具有可持续性。

2、公司毛利率与同行业可比公司的差异主要系受主营产品不同的影响。报告期内，公司毛利率水平受下游旺盛的市场需求、公司技术优势及公司所属行业较高的毛利率水平等综合影响。报告期内，公司综合毛利率与同行业毛利率平均水平不存在显著差异，不存在重大异常情况。

3、报告期内，公司扣非后归母净利润有所波动主要系受营业毛利、期间费用等变动综合所致。报告期内，公司营业收入及毛利均有所增长，公司期间费用随着业务规模扩大呈现出相应增长，其中，又以研发费用增长较为显著。在研发

规模相对较大的背景下，研发费用的增长部分抵消了营业收入及毛利增长对业绩的影响，导致报告期内公司净利润及扣非后归母净利润有一定波动。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异，主要系是受存货、经营性应收应付项目的影 响，与公司生产经营活动实际开展的情况相符，具有合理性。

## 5、关于存货

根据申报材料：（1）报告期各期末，公司存货金额分别为 53,873.97 万元、86,133.50 万元、111,198.83 万元、155,487.73 万元，公司存货以原材料、在产品和发出商品为主，存货跌价准备以原材料、发出商品为主；（2）公司自 2023 年 4 月 1 日起对存货会计政策进行变更，发出存货计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”，上述会计政策变更经董事会批准。

请发行人说明：（1）结合公司的采购及生产销售模式，说明报告期末存货金额持续大幅增加的原因及合理性，相关存货规模与公司产销规模是否匹配；（2）结合报告期内主要存货类型的库龄、在手订单覆盖情况、期后结转情况、发出商品及原材料存货跌价准备余额的主要构成及跌价原因、与同行业可比公司存货跌价准备计提情况等，进一步说明公司存货跌价准备计提的充分性；（3）报告期各期末，公司发出商品对应的产品预计收入及毛利率情况，是否存在毛利率过低、长时间未验收的发出商品，是否存在应结转未予结转的发出商品或其他存货类型；（4）公司 2023 年调整发出存货计价方法的原因及对公司财务数据的主要影响。请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

## 【回复】

## 一、发行人说明

**（一）结合公司的采购及生产销售模式，说明报告期内存货金额持续大幅增加的原因及合理性，相关存货规模与公司产销规模是否匹配**

### 1、公司采购、生产及销售模式

#### （1）采购模式

公司主要根据生产计划、物料清单和零部件的库存情况确定零部件的采购计划，并按照采购计划进行采购。

公司的采购流程如下：A.设备生产阶段所需物料由制造中心根据生产需求制定物料清单，提交至物控部审核；B.物控部结合物料清单以及零部件的库存确定物料采购清单，并提交至采购部执行，采购部负责与供应商接洽、确定采购合同细节；C.原材料交付后，针对不同类型的原材料，由品质部门负责原材料的质量检测；D.入库完成采购。

#### （2）生产模式

报告期内，公司主要根据销售订单及销售预测进行生产。公司市场部负责市场研判并接收客户需求，市场部根据客户需求内部立项后，由总经理审批，审批通过后由物控部安排采购计划并由采购部执行采购。制造中心根据物料到达时间、订单交付时间等制定生产计划和安排生产。制造中心对装配调试后的成品进行检验，检验合格后成品入库。

公司生产周期主要受设备成熟程度、物料到达时间、客户需求紧迫程度等影响，存在一定波动。以公司收入占比较高的无图形晶圆缺陷检测设备及图形晶圆缺陷检测设备为例，无图形晶圆缺陷检测的生产周期通常为 3-8 个月，图形晶圆缺陷检测设备的生产周期通常为 2-6 个月。

#### （3）销售模式

公司主要产品为检测和量测设备，公司产品和服务主要以直销模式进行，即由公司直接将产品销售给客户。公司市场部负责市场开发、产品的销售，同时，由客户服务部负责公司产品客户支持工作。

公司产品销售交付过程中，公司产品会涉及发货、安装及验收等流程，整个业务流程周期相对较长，其中，验收周期波动主要受客户产线类型、客户投产情况、客户验收标准及设备成熟度等因素影响，会存在一定的波动。以公司收入占比较高的无图形晶圆缺陷检测设备及图形晶圆缺陷检测设备为例，无图形晶圆缺陷检测的验收周期通常为 2-9 个月，图形晶圆缺陷检测设备的生产周期通常 2-9 个月。

## 2、报告期内存货金额持续大幅增加的原因及合理性，相关存货规模与公司产销规模是否匹配

### （1）报告期内，公司存货增长的主要内容

报告期内，公司存货增长情况及具体构成如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
存货金额	<b>174,676.15</b>	111,198.83	86,133.50
存货金额增加额	<b>63,477.32</b>	25,065.33	/
其中：			
原材料增加额	<b>21,394.21</b>	10,486.42	/
在产品增加额	<b>14,273.45</b>	9,457.77	/
发出商品增加额	<b>28,373.96</b>	2,579.84	/
库存商品增加额	<b>-1,067.23</b>	2,561.30	/
合同履约成本增加额	<b>502.94</b>	-19.99	/
委托加工物资增加额	-	-	/

由上可见，报告期各期末，公司存货金额分别为 86,133.50 万元、111,198.83 万元及 **174,676.15 万元**，较上期分别增长 25,065.33 万元及 **63,477.32 元**。

公司存货规模增长主要又以原材料、在产品及发出商品增加为主。原材料、在产品及发出商品金额增长的原因如下：

#### ①原材料

报告期各期末，公司原材料金额较上期末分别增长 10,486.42 万元及

**21,394.21 万元**，主要系公司收入规模持续快速增长，在手订单及销售预测保持快速增长，原材料采购量相应增加；此外，随着公司产品种类不断丰富，原材料种类相应增加，对应的采购量及备货亦有所增长。

②在产品

报告期各期末，公司在产品金额较上期分别增长 9,457.77 万元及 **14,273.45 万元**，主要系公司业务规模快速增长，客户订单增加，在产品规模随之增长。

③发出商品

公司发出商品主要为已发货尚未完成验收的设备。报告期各期末，公司发出商品金额较上期分别增长 2,579.84 万元及 **28,373.96 万元**，发出商品金额有所增长，主要系公司处于高速成长期，业务规模及生产规模增长较快，正在履行中的订单规模较大，公司产品生产完成后即发送给客户，发出商品至完成验收存在一定的验收周期，部分发出商品尚未完成验收所致。

(2) 存货规模与产销规模的匹配情况

报告期内，公司产销规模及存货余额情况如下：

单位：万元、台

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	<b>138,037.88</b>	89,090.01	50,923.53
营业收入同比增速	<b>54.94%</b>	74.95%	/
产量	<b>384</b>	197	232
存货余额	<b>179,762.07</b>	114,428.36	89,012.38
存货同比增速	<b>57.10%</b>	28.55%	/

由上可见，报告期内随着公司收入的快速攀升，存货余额随之增长。公司主要根据销售订单及销售预测进行生产，采购部门主要根据生产计划、物料清单和零部件的库存情况确定采购计划，并按照采购计划进行采购。因此，存货增长主要受收入规模及订单的影响。**2022 年度至 2024 年度**，公司营业收入复合增长率为 **64.64%**，存货复合增长率为 **42.11%**，存货规模增长速度与收入增长速度不存在异常情况；报告期内，公司产量整体呈上升趋势，其中，2023 年度公司产量有所

波动主要系生产的产品结构影响所致，不存在重大异常情况。

综上所述，报告期内，公司存货金额大幅增长与公司产销规模相匹配，具有合理性，不存在重大异常情况。

**（二）结合报告期内主要存货类型的库龄、在手订单覆盖情况、期后结转情况、发出商品及原材料存货跌价准备余额的主要构成及跌价原因、与同行业可比公司存货跌价准备计提情况等，进一步说明公司存货跌价准备计提的充分性**

**1、主要存货类型的库龄情况**

报告期各期末，公司主要存货库龄情况如下：

单位：万元

2024年12月31日				
项目	1年以内	1年以上	合计	1年以内占比
原材料	47,489.28	9,272.67	56,761.95	83.66%
在产品	39,010.56	5,842.90	44,853.46	86.97%
库存商品	2,735.06	54.30	2,789.36	98.05%
发出商品	63,574.71	10,924.77	74,499.48	85.34%
小计	152,809.61	26,094.64	178,904.25	85.41%
2023年12月31日				
项目	1年以内	1年以上	合计	1年以内占比
原材料	28,041.71	6,020.75	34,062.46	82.32%
在产品	23,054.04	7,206.04	30,260.08	76.19%
库存商品	3,976.30	-	3,976.30	100.00%
发出商品	29,199.39	16,575.24	45,774.63	63.79%
小计	84,271.44	29,802.03	114,073.47	73.87%
2022年12月31日				
项目	1年以内	1年以上	合计	1年以内占比
原材料	20,831.14	2,172.81	23,003.95	90.55%
在产品	15,569.98	5,922.79	21,492.77	72.44%

库存商品	1,422.30	-	1,422.30	100.00%
发出商品	32,206.66	10,511.83	42,718.49	75.39%
<b>小计</b>	<b>70,030.08</b>	<b>18,607.43</b>	<b>88,637.51</b>	<b>79.01%</b>

注：上述金额系各项存货不含存货跌价准备的余额。

由上可见，报告期各期末，公司主要存货类型的库龄以1年以内为主，1年以内存货占存货比例在70%以上，整体库龄较短。

## 2、在手订单覆盖情况

报告期内，随着公司及各类型设备在市场认可度的提升、产品型号的日益丰富，产品订单持续增长，订单覆盖率处于较高水平。具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
期末账面余额	<b>122,142.30</b>	80,011.01	65,633.56
订单覆盖金额	<b>93,729.39</b>	59,382.10	50,919.13
订单覆盖率	<b>76.74%</b>	76.22%	81.14%

注1：期末订单覆盖率=订单覆盖的存货余额/存货期末余额，存货期末账面余额为在产品、库存商品及发出商品的账面余额，不含存货跌价准备。

## 3、期后结转情况

报告期内，公司发出商品期后结转情况如下：

单位：万元、台

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
发出商品账面余额	<b>74,499.48</b>	45,774.63	42,718.49
期后结转金额	<b>1,377.30</b>	<b>34,359.91</b>	<b>37,711.11</b>
期后结转比例	<b>1.85%</b>	<b>75.06%</b>	<b>88.28%</b>
发出商品订单覆盖率	<b>100.00%</b>	100.00%	100.00%

注1：期后结转比例=期后销售结转成本的发出商品账面余额/期末发出商品余额；

注2：发出商品期后结转统计至2025年2月末。

由上可见，2022年度及2023年度，公司期后结转情况良好，期后结转比例稳步提升，不存在重大异常情况。2024年12月31日期后结转略低主要系受期后结转时间相对较短的影响。与此同时，报告期内，公司发出商品订单覆盖率接近

100%，发出商品期末订单覆盖情况不存在重大异常情况。

综上所述，报告期各期末，公司发出商品不存在重大异常情况。

#### 4、发出商品及原材料存货跌价准备余额的主要构成

报告期各期末，公司发出商品及原材料存货跌价准备情况及主要构成如下：

单位：万元

项目	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
原材料账面余额	56,761.95	34,062.46	23,003.95
原材料跌价准备计提情况	2,423.89	1,118.61	546.51
其中：光学类	1,604.21	593.35	400.25
机械类	604.50	323.57	112.24
小计	2,208.71	916.92	512.49
占原材料跌价准备计提比例	91.12%	81.97%	93.78%
项目	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
发出商品账面余额	74,499.48	45,774.63	42,718.49
发出商品跌价准备计提情况	2,157.39	1,806.30	1,329.99
其中：套刻精度量测设备	657.77	309.14	349.46
介质薄膜膜厚量测设备	537.19	165.23	150.28
图形晶圆缺陷检测设备	368.88	650.90	50.81
显示面板缺陷检测设备	-	634.19	722.48
小计	1,563.84	1,759.46	1,273.03
占发出商品跌价准备计提比例	72.49%	97.41%	95.72%

报告期内，公司的原材料主要为光学类、机械类、电气类及其他零部件，其中原材料存货跌价计提主要涉及光学类和机械类，主要原因系公司对部分因客户需求变更及设计方案变更已无使用价值的材料全额计提存货跌价。

报告期各期末，公司会存在一定规模的发出商品。公司发出商品存货跌价计提主要涉及套刻精度量测设备、介质薄膜膜厚量测设备、图形晶圆缺陷检测设备及显示面板缺陷检测设备等产品。截至2024年12月31日，公司发出商品计提存

货跌价的主要原因如下：

单位：万元

产品系列	报告期末存货跌价余额	存货跌价准备计提的主要情况
套刻精度量测设备	657.77	系导入客户的同系列首台设备，验证周期较长，验证过程中投入的成本较大，导致部分产品可变现净值低于账面成本
介质薄膜膜厚度量测设备	537.19	该系列产品销售价格较低，导致部分产品可变现净值低于账面成本
图形晶圆缺陷检测设备	368.88	系向重点客户销售，基于量大价优的销售策略，产品销售价格较低，导致部分产品可变现净值低于账面成本
合计	1,563.84	

#### 5、与同行业相比，公司存货跌价准备计提比例处于合理水平

报告期内，公司建立健全了与存货相关的内部控制制度，并根据自身产品特点和业务情况制定了存货跌价计提政策。报告期各期末，公司会根据相关存货状况、订单情况等判断存货是否存在减值迹象并计提相应的存货跌价准备，公司按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

报告期末，公司与同行业存货跌价准备计提情况如下表所示：

公司名称	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
盛美上海	1.15%	0.72%	0.87%
中微公司	未披露	2.15%	2.97%
芯源微	未披露	0.58%	0.29%
华海清科	未披露	1.65%	0.86%
华峰测控	2.27%	2.24%	1.36%
平均值	1.71%	1.47%	1.27%
中科飞测	2.83%	2.82%	3.23%

由上可见，与同行业可比公司相比，公司存货跌价计提比例高于同行业平均水平，与同行业可比公司不存在重大差异。

综上所述，报告期内，公司存货库龄状况良好，库龄以一年以内为主，不存在重大异常情况；公司订单规模充分，期后结转销售情况不存在重大异常情况。

公司存货跌价准备的计提情况与同行业可比公司存货跌价准备计提情况不存在重大差异情况。报告期内，公司存货跌价准备计提是充分的。

**（三）报告期各期末，公司发出商品对应的产品预计收入及毛利率情况，是否存在毛利率过低、长时间未验收的发出商品，是否存在应结转未予结转的发出商品或其他存货类型**

公司发出商品为已发出但尚未完成验收的设备。报告期各期末，发出商品占存货余额的比例分别为 47.99%、40.00%和 **41.44%**，相对较高的背景主要系公司正处于高速成长期，报告期内正在履行中的订单规模较大以及公司产品生产完成后至完成验收存在一定的验收时间，整个业务流程周期相对较长的影响所致。

**1、报告期各期末，公司发出商品对应的产品预计收入及毛利率情况**

报告期各期末，公司发出商品对应的产品预计收入及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
发出商品账面余额	<b>74,499.48</b>	45,774.63	42,718.49
预计收入	<b>175,031.60</b>	92,811.76	80,898.15
预计毛利率	<b>55.59%</b>	50.73%	46.92%
当期综合毛利率	<b>48.90%</b>	<b>47.77%</b>	48.67%

注 1：预计收入系根据各报告期末预计售价统计，预计售价为合同价格或该系列产品平均售价（未有合同价格的情况）；

注 2：预计毛利率系根据预计售价减去发出商品账面成本及预计完工成本计算得出，不含预估的销售费用及相关税费。

报告期各期末，公司发出商品预计可实现收入分别为 80,898.15 万元、92,811.76 万元及 **175,031.60 万元**，预计毛利率分别为 46.92%、50.73%及 **55.59%**，整体上略高于公司当期综合毛利率，不存在重大差异。报告期内，公司存在部分发出商品产品毛利率偏低的情况（低于 20%），该产品一定程度上影响了当期发出商品的预计毛利率水平。报告期各期，发出商品毛利率偏低（低于 20%）主要涉及以下产品，具体情况如下：

单位：万元

毛利率偏低原因	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	产品系列	涉及客户
产品销售给集成电路先进封装或泛半导体领域时，整体毛利率水平较低	5,334.37	6,894.87	4,744.44	已申请豁免披露	已申请豁免披露
产品市场竞争相对充分，因此销售单价、毛利率较低	5,558.62	3,039.02	1,735.63		
基于量大价优的销售策略，产品销售价格相对偏低，导致毛利率较低	925.57	557.18	-		
公司推出的新产品系列，前期生产成本较高	3,552.47	2,583.71	2,224.25		
公司产品首次导入新客户/新产品首次导入，销售价格较优惠	3,647.67	785.33	1,443.29		
<b>合计</b>	<b>19,018.70</b>	<b>13,860.11</b>	<b>10,147.61</b>		

由上可见，报告期各期末，公司存在一定规模毛利率偏低的发出商品，该种情况主要系受产品具体类别、市场竞争状况以及公司销售策略等因素的综合影响，有其商业合理性，不存在重大异常情况。

## 2、是否存在长时间未验收的发出商品情况，是否存在应结转未予结转的发出商品或其他存货类型

### (1) 发出商品验收周期影响因素

公司主营业务为高端半导体质量控制设备的研发、生产和销售。公司主要根据销售订单及销售预测进行生产。在产品交付过程中，公司产品会涉及生产、发货、安装及验收等流程，整个业务流程周期相对较长，报告期内，公司设备验收周期存在一定波动，主要系受客户产线类型、客户投产情况、客户验收标准及设备成熟度等因素影响。具体包括如下因素：

序号	影响因素	主要情形
1	客户产线类型	不同客户或相同客户不同产线对验收周期存在一定影响，先进制程一般相对普通制程验收周期长

序号	影响因素	主要情形
2	客户投产情况	客户产线建设进度、车间厂务条件等会对公司设备验收周期产生一定影响。设备验收因产线建设延缓或厂务条件现场环境未达标等因素延长验收周期，或因客户投产进度急迫验收周期较短
3	客户验收标准	不同客户对设备验收标准（包括但不限于验证产品种类、产品工艺、验收指标）以及验收的内部制度和流程存在差异会影响设备验收周期
4	公司设备成熟度	公司同型号设备推出初期的设备验收周期通常相对较长，设备相对成熟后稳定性提升，验收周期一般有所缩短
5	其他	1、验收涉及双方人员深度参与，部分产品验收因客户人员紧张会对验收周期产生一定的影响； 2、合同或相关协议明确约定验收周期、客户内部采购预算审批的情况等不可抗力因素等亦会对验收周期产生一定的影响

(2) 报告期末公司长期未验收发出商品具体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司报告期末发出商品中期后未结转的共 155 台，其中库龄在 1 年以上的未结转发出商品共 30 台，具体情况如下：

单位：万元

序号	长期未结转原因	报告期末账面余额	涉及客户
1	该等产品为 Demo 设备，验证周期相对较长	5,314.91	已申请豁免披露
2	因客户产线建设进度、客户设计需求变更等原因，导致验收周期相对较长	3,255.31	
3	公司产品首次导入该客户以及新推出新系列产品，验证周期相对较长	1,326.13	
合计		9,896.35	

上表中长期未结转发出商品中超过 300 万元涉及 15 台，金额为 7,356.10 万元，相关发出商品未结转的具体情况已申请豁免披露。

综上所述，报告期内，公司发出商品验收情况受客户设计需求变更、产线建设进度、公司设备成熟度等多方面因素影响。截至报告期末，公司长期未验收的发出商品皆有一定的特殊背景，不存在重大异常情况，不存在应结转未予结转的发出商品。

#### （四）公司 2023 年调整发出存货计价方法的原因及对公司财务数据的主要影响

##### 1、公司 2023 年调整发出存货计价方法的原因

报告期内，为了更好地实现成本动态管理，实现对生产成本的精细化管控，进一步提升公司的管理水平，细化对各项指标的管控，公司引入企业资源计划管理系统，并自 2023 年 4 月起对存货会计政策进行变更，发出存货计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。上述会计政策变更已于 2023 年 4 月 28 日经第一届董事会第二十二次会议批准。

##### 2、发出存货计价方法的调整对公司财务数据的影响

单位：万元

2023 年 1-3 月			
项目	变更前	变更后	影响金额
存货	91,895.31	91,896.59	1.28
净利润	3,135.43	3,136.71	1.28
2022 年度			
项目	变更前	变更后	影响金额
存货	86,147.30	86,133.50	-13.80
净利润	1,210.89	1,197.09	-13.80

由上可见，报告期内，存货会计政策变更对公司财务状况影响较小。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有利于更好地实现成本动态管理，实现对生产成本的精细化管控，进一步提升公司的管理水平。

## 二、申报会计师核查意见

### （一）核查程序

针对上述事项，申报会计师主要执行了以下核查程序：

1、访谈公司的管理层，了解公司业务模式，分析公司存货余额结构与公司

产品结构和生产特点的匹配性；

2、获取并查阅发行人存货明细表、报告期各期末各类存货的库龄结构情况，分析存货构成变动情况、库龄分布等相关情况；

3、获取报告期各期末的在产品、库存商品和发出商品清单，查阅报告期内公司合同明细和销售明细，复核报告期各期末发出商品的订单支持情况及期后结转销售情况；

4、查阅发行人存货跌价准备计提政策，获取并复核公司报告期各期末存货跌价准备测算表，复核公司报告期各期末存货跌价准备计提的准确性和充分性；

5、对报告期末的存货进行了存货监盘程序，了解存货的状况，核查公司存货是否存在明显呆滞等存在减值迹象的情况。同时，函证发出商品报告期各期末的余额情况，确认报告期各期末发出商品余额的准确性，**2024年度发出商品发函比例为79.42%，回函可确认发出商品金额比例为56.51%，针对未回函，执行替代程序可确认发出商品金额比例为22.92%。报告期末公司发出商品余额不存在异常情况。**

6、查阅发行人2023年年度报告，了解存货计价方式变更情况并分析复核发行人本次会计政策变更的合理性及其影响。

## **（二）核查结论**

经核查，申报会计师认为：

1、报告期内，公司存货规模主要随着公司业务规模扩大而增长，存货规模增长与公司产销规模相匹配，具备合理性；

2、报告期内发行人存货跌价准备计提符合公司实际情况，存货整体库龄情况相对较好，在手订单覆盖率及期后结转情况良好，报告期内发行人存货跌价准备计提充分，与同行业可比公司不存在重大差异情况；

3、报告期内，公司发出商品验收情况受客户设计需求变更、产线建设进度、公司设备成熟度等多方面因素影响。公司长期未验收的发出商品有一定的特殊背景，不存在重大异常情况，不存在应结转未予结转的发出商品；

4、公司 2023 年调整存货计价方法对会计核算结果不会产生重大影响，不会对公司净利润、股东权益产生重大影响。

## 6、关于其他

6.1 请发行人说明：（1）报告期各期末公司应付账款的主要对手方及应付金额、采购内容，应付账款规模是否与相关期间的收入、采购金额相匹配，是否存在长期未付的应付账款及其原因；（2）公司的信用政策及信用期情况，报告期内应收账款金额持续上升的原因，是否存在放松信用政策的情形；（3）结合应收账款的账龄及期后回款、逾期情况、同行业可比公司坏账计提情况等，说明公司坏账准备计提的充分性。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

### 【回复】

#### 一、发行人说明

（一）报告期各期末公司应付账款的主要对手方及应付金额、采购内容，应付账款规模是否与相关期间的收入、采购金额相匹配，是否存在长期未付的应付账款及其原因

#### 1、报告期各期末公司应付账款的主要对手方及应付金额、采购内容

报告期各期末，公司应付账款主要对手方及采购内容如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	应付账款余额	采购金额	采购内容
2024 年	1	北京华卓精科科技股份有限公司	1,712.50	8,790.23	机械类
	2	北京初芯集智科技有限公司	1,448.74	4,382.17	电气类等
	3	东莞市鼎图精密机械设备有限公司	1,333.58	2,934.92	机械类等
	4	诺银机电	1,275.43	2,477.79	电气类
	5	深圳志强视觉科技发展有限公司	1,177.08	2,984.65	光学类

年份	序号	供应商名称	应付账款 余额	采购金额	采购内容
	合计		<b>6,947.34</b>	<b>21,569.76</b>	
	占比		<b>20.77%</b>	<b>16.40%</b>	
2023年	1	北京华卓精科科技股份有限公司	1,687.02	4,486.32	机械类
	2	乐孜公司	1,556.74	5,645.58	机械类
	3	北京初芯集智科技有限公司	746.44	1,083.54	电气类等
	4	东莞市鼎图精密机械设备有限公司	722.75	1,381.36	机械类等
	5	诺银机电	680.06	1,070.07	电气类
	合计		<b>5,393.01</b>	<b>13,666.87</b>	
	占比		<b>34.33%</b>	<b>22.19%</b>	
2022年	1	乐孜公司	3,562.03	6,976.27	机械类
	2	北京华卓精科科技股份有限公司	1,277.99	3,696.22	机械类
	3	已申请豁免披露	605.26	5,387.35	光学类
	4	东莞市鼎图精密机械设备有限公司	351.79	977.68	机械类
	5	已申请豁免披露	319.40	1,196.48	其他类
	合计		<b>6,116.47</b>	<b>18,234.00</b>	
	占比		<b>57.90%</b>	<b>32.05%</b>	

注 1：采购金额为原材料采购金额；

注 2：同一实际控制人控制的企业合并计算口径

报告期内，公司向应付账款主要供应商采购的主要内容涉及光学类、机械类、电气类等原材料。报告期内，公司应付账款主要供应商相对稳定，应付账款相对分散，不存在异常情况。

## 2、应付账款余额与相关期间的收入、采购金额匹配情况

报告期各期，应付账款余额与营业收入、采购金额的匹配关系如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
应付账款余额	<b>33,441.01</b>	15,709.39	10,563.37

项目	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53
应付账款余额占营业收入比例	24.23%	17.63%	20.74%
采购金额	131,553.24	61,594.80	56,892.31
应付账款余额占采购金额比例	25.42%	25.50%	18.57%

报告期内，公司营业收入呈现快速增长的趋势，随着公司业务规模扩大，材料采购对应的应付账款余额亦同步增加。报告期内，公司应付账款占采购金额的比例分别为 18.57%、25.50%及 25.42%，整体相对稳定。

### 3、是否存在长期未付的应付账款及其原因

报告期各期，公司应付账款的账龄具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	33,206.59	24,262.47	15,459.46
1年以上	234.42	233.53	249.93
合计	33,441.01	24,496.00	15,709.39
1年以上占比	0.70%	0.95%	1.59%

由上可见，公司应付账款账龄主要集中在1年以内，1年以上应付账款占比分别为 1.59%、0.95%及 0.70%，占比较小，不存在长期未付的应付账款。

## （二）公司的信用政策及信用期情况，报告期内应收账款金额持续上升的原因，是否存在放松信用政策的情形

### 1、公司的信用政策及信用期情况

公司在与客户签订销售合同时，会根据行业惯例、客户背景、合作历史等情况确定收款条件及收款方式。公司与客户通常在合同签订、设备发货、设备验收、质保期满分期收取货款，具体的付款比例系公司与客户商业谈判的结果。公司的信用期通常为 6 个月。报告期内，公司的信用政策整体保持稳定，不存在重大变化。

## 2、报告期内公司应收账款金额持续上升的原因

报告期内，公司应收账款与营业收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
应收账款余额	37,414.50	16,911.84	13,569.69
营业收入	138,037.88	89,090.01	50,923.53
应收账款余额占营业收入比例	27.10%	18.98%	26.65%
应收账款余额增长率	121.23%	24.63%	43.01%
营业收入增长率	54.94%	74.95%	41.24%

报告期各期末，公司应收账款持续增长主要系营业收入规模持续增长所致。2022年度至2024年度，公司应收账款复合增长率为**65.18%**，公司营业收入的复合增长率为**64.64%**，应收账款余额与营业收入变动趋势基本一致，不存在异常情况。2022年末至2024年末，公司应收账款余额占当期营业收入比例分别为26.65%、18.98%及**27.10%**，整体相对稳定，应收账款的管理状况良好。2024年末公司应收账款增长幅度大于营业收入增长率，主要系公司与主要客户尚未到结算期所致。

报告期内，公司客户主要为半导体行业知名企业，公司与主要客户合作关系、结算模式稳定，商业信誉良好，付款能力较强，期后回款良好，应收账款回款风险较小。

综上所述，报告期内，公司与主要客户的结算周期及信用政策未发生重大变化，应收账款增长主要系随着公司营业收入的增长同步增长，不存在放松信用政策的情况。

**（三）结合应收账款的账龄及期后回款、逾期情况、同行业可比公司坏账计提情况等，说明公司坏账准备计提的充分性**

### 1、应收账款账龄及期后回款、逾期情况

#### （1）应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

账龄	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
6个月以内（含6个月）	65.01%	76.83%	85.94%
7-12个月（含12个月）	25.35%	5.77%	3.57%
小计	90.37%	82.60%	89.51%
1-2年（含2年）	4.23%	11.19%	6.93%
2-3年（含3年）	4.06%	4.79%	3.57%
3年以上	1.34%	1.42%	-
合计	100.00%	100.00%	100.00%

报告期各期末，公司应收账款的账龄集中于1年以内，占比分别为89.51%、82.60%及90.37%。公司应收账款账龄较好，不存在重大异常情况。

（2）应收账款期后回款及逾期情况

报告期各期末，公司应收账款情况及截至2025年2月28日期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
应收账款账面余额	37,414.50	16,911.84	13,569.69
期后回款情况	10,894.05	15,034.05	12,423.79
期后回款比例	29.12%	88.90%	91.56%
项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
应收账款账面余额	37,414.50	16,911.84	13,569.69
其中：逾期金额	13,089.89	3,917.79	1,908.49
逾期金额占比	34.99%	23.17%	14.06%

注1：期后回款均统计至2025年2月末。

报告期内，公司客户主要为半导体领域的知名企业，偿还能力较强，公司应收账款期后回款整体情况良好，2024年12月31日期后回款比例相较于其他各期较低主要系期后统计时间较短所致。报告期内，公司应收账款期后回款不存在异

常情况。

报告期各期末，公司应收账款逾期比例有一定波动，其中，2023年末和**2024年末**逾期应收账款比例相较于报告期前期有增长主要系受个别客户的款项暂时性逾期所致，其中：

2023年末应收账款逾期主要涉及2个客户，逾期金额分别为1,369.25万元和517.38万元，合计占当期期末逾期应收账款的比例48.16%，主要受其资金支付安排影响导致应收账款暂时性逾期。截至本回复出具日，前述客户逾期应收账款已回款989.33万元，已回款金额占其逾期金额的比例为52.44%。

**2024年末**应收账款逾期主要涉及5个客户，逾期金额分别为**4,116.00万元、1,090.74万元、1,035.70万元、893.71万元及881.40万元**，占当期期末逾期应收账款的比例为**61.60%**。逾期的主要原因系其内部付款审批流程较长，导致其应收账款存在暂时性逾期或受其内部资金支付安排影响。截至本回复出具日，前述客户逾期应收账款已回款**5,151.70万元**，已回款金额占逾期金额的比例为**64.26%**。报告期内，公司客户资信情况良好，公司客户质量不存在重大不利变化的情况，不存在需单项计提坏账准备的情况，公司应收账款回收情况整体不存在较大风险。

剔除上述客户的个别影响后，公司2023年度和**2024年度**剩余逾期金额占应收账款比例分别为12.01%及**13.36%**，与报告期其他各期不存在重大异常。同时，公司会持续密切关注应收账款的回款收情况并采取包括及时催收等措施确保公司应收账款的回收不存在重大风险。

## 2、同行业可比公司坏账计提情况

报告期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账计提政策情况如下：

账龄	中微公司	芯源微	盛美上海	华海清科	华峰测控	发行人
6个月以内	1.39-2.18%	5.00%	1.00%	1.00%	5.00%	2.00%
7-12个月	1.39-2.18%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
1至2年（含2年）	4.14-14.25%	10.00%	10.00%	15.00%	30.00%	10.00%

账龄	中微公司	芯源微	盛美上海	华海清科	华峰测控	发行人
2至3年（含3年）	8.99-71.25%	30.00%	20.00%	20.00%	70.00%	15.00%
3至4年（含4年）	64.14-99.73%	50.00%	25.00%	30.00%	100.00%	30.00%
4至5年（含5年）	100.00%	80.00%	30.00%	50.00%	100.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

由上可见，公司各账龄计提比例均处于可比上市公司相应比例区间内。公司应收账款坏账计提比例总体与同行业可比公司无重大差异，坏账准备计提政策是谨慎的。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况与同行业可比公司对比情况如下：

同行业可比公司	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
盛美上海	6.66%	5.21%	3.60%
中微公司	未披露	2.58%	3.10%
芯源微	未披露	5.90%	5.96%
华海清科	未披露	4.25%	2.27%
华峰测控	11.68%	11.47%	9.33%
平均值	9.17%	5.88%	4.85%
中科飞测	4.13%	4.09%	3.13%

由上可见，报告期内公司应收账款坏账政策及坏账计提情况处于同行业上市公司合理区间内，不存在显著差异。同时，公司及同行业可比公司坏账计提比例占应收账款的具体比例情况与各公司应收账款账龄的具体情况密切相关，公司坏账准备计提情况符合公司实际情况，坏账准备计提充分，不存在重大异常情况。

综上所述，公司应收账款账龄结构合理，客户回款良好、发行人与同行业可比公司应收账款坏账准备计提政策不存在重大差异，发行人应收账款坏账准备计提充分、合理。

## 二、申报会计师核查意见

### （一）核查程序

针对上述事项，申报会计师主要执行了以下核查程序：

1、获取发行人应付账款和采购数据情况，了解报告期各期前五大供应商情况及采购内容，分析应付账款与采购金额、营业收入的匹配关系；

2、获取公司应收账款账龄明细表，了解应收账款账龄情况及逾期情况，评估公司对该应收账款坏账计提是否充分；

3、访谈公司管理层，了解公司销售业务流程、主要客户的信用状况、发行人对其信用政策及信用期等情况和变化；

4、获取公司银行流水，对公司应收账款的期后回款情况进行检查，统计和分析各期末应收账款期后回款占比情况；

5、访谈公司主要客户，了解其与公司合同付款约定相关情况以及实际执行情况是否与合同约定一致，了解报告期内发行人的信用政策是否发生变化等；

6、查阅公司同行业可比上市公司坏账计提政策、应收账款账龄分布情况、应收账款周转率，与公司进行对比分析，并结合公司实际分析和评价公司坏账准备计提政策适当性；

7、对报告期内主要客户及主要供应商进行函证，确认应收账款及应付账款的真实性。

### （二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、报告期内，随着收入规模持续增长，公司采购额呈现增长趋势，应付账款余额亦相应增加，应付账款余额与营业收入及采购金额相匹配；公司不存在长期未付的应付账款。

2、报告期内，公司主要客户信用政策未发生重大变化，不存在放宽信用政策刺激销售的情形。

3、报告期内，公司应收账款账龄结构以1年以内为主，报告期各期末主要应收余额客户期后回款情况良好。公司已对存货计提了充分的跌价准备，存货跌价计提比例处于合理区间，与同行业可比公司不存在重大差异。

**6.2 请发行人说明：（1）结合中科共芯的相关投资协议约定情况、中科共芯对外投资标的相关业务与发行人主营业务及相关产业链的关系等，说明未将其认定为财务性投资的原因；（2）截至最近一期末公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资情况。**

**请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。**

**【回复】**

**一、发行人说明**

**（一）结合中科共芯的相关投资协议约定情况、中科共芯对外投资标的相关业务与发行人主营业务及相关产业链的关系等，说明未将其认定为财务性投资的原因**

中科共芯由广州中科齐芯半导体科技有限责任公司、珠海中科飞测与盛美上海、拓荆科技、微导纳米等其他半导体设备上市公司共同设立，根据《广州中科共芯半导体技术合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定，中科共芯仅投资于锐立平芯微电子（广州）有限责任公司之公司股权（以下简称“锐立平芯”）。

根据锐立平芯官网及官方公众号，锐立平芯系基于 FD-SOI 工艺的国产晶圆制造厂商。公司系国内高端质量控制设备厂商，锐立平芯与公司在产业链上属于上下游。

根据《证券期货法律适用意见第18号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。金额较大是指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司

净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

公司对锐立平芯的投资目的是加强在集成电路产业链的业务布局、与产业链上下游形成更密切的合作关系、拓展公司客户资源渠道，与主营业务具有较强的相关性和协同性，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

同时，经检索前述产业链上市公司对中科共芯的投资认定案例，其亦未将对中科共芯的投资认定为财务性投资，与公司认定具有一致性，具体情况如下：

上市公司	是否认定为财务性投资	不认定为财务性投资的原因
盛美上海	否	锐立平芯微电子（广州）有限责任公司系基于 FD-SOI 工艺的国产晶圆制造厂商，与公司主营业务存在协同效应；围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资
微导纳米	否	锐立平芯作为集成电路制造厂商，是公司半导体设备领域重要的潜在客户，公司作为国内半导体薄膜沉积设备代表性供应商之一，投资锐立平芯与公司主营业务具有较强的相关性和协同性，符合公司主营业务及战略发展方向；围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资

**（二）截至最近一期末公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资情况**

**1、截至最近一期末公司未持有金额较大的财务性投资**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外投资的相关科目列示如下：

单位：万元

序号	项目	金额	是否包含财务性投资
1	交易性金融资产	-	否
2	其他应收款	1,330.73	否
3	其他流动资产	8,167.25	否
4	一年内到期的非流动资产	6,407.69	否

序号	项目	金额	是否包含财务性投资
5	其他债权投资	32,148.73	否
6	长期应收款	-	-
7	长期股权投资	-	-
8	其他权益工具投资	5,000.00	否
9	其他非流动资产	5,851.14	否

(1) 交易性金融资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在交易性金融资产。

(2) 其他应收款

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要系保证金、押金、代收代付款、备用金，不属于财务性投资。

(3) 其他流动资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他流动资产主要系待结算已开票税额、待抵扣/未认证的进项税等，不属于财务性投资。

(4) 一年内到期的非流动资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产主要系一年内到期的可转让大额存单，不属于财务性投资。

(5) 其他债权投资

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他债权投资主要系一年以上可转让定期存单，不属于财务性投资。

(6) 其他权益工具投资

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他权益工具投资为公司子公司向广州中科共芯半导体技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科共芯”）投资 5,000.00 万元。中科共芯由广州中科齐芯半导体科技有限责任公司、珠海中科飞测及盛美上海、拓荆科技、微导纳米等其他半导体设备上市公司共同设立，主要投资锐立平

芯微电子（广州）有限责任公司，锐立平芯系基于 FD-SOI 工艺的国产晶圆制造厂商，与公司在产业链上属于上下游。公司投资目的主要系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产主要系预付软件和设备购买款等，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期末公司不存在财务性投资情况。

**2、本次发行董事会前六个月至今公司不存在新投入和拟投入的财务性投资**

公司本次发行董事会会议于 2024 年 12 月 6 日召开，本次发行董事会决议日前六个月（即 2024 年 6 月 6 日）至本回复出具日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，具体情况如下：

序号	项目	本次发行董事会决议日前六个月至本回复报告出具日情况
1	投资类金融业务	不存在投资融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等类金融业务情形
2	非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）	不存在投资金融业务的情形，也不存在向集团财务公司出资或增资的情形
3	与公司主营业务无关的股权投资	不存在与主营业务无关的股权投资
4	投资产业基金、并购基金	不存在投资产业基金、并购基金的情形
5	拆借资金、委托贷款	不存在实施对外拆借资金、委托贷款的情形
6	购买收益波动大且风险较高的金融产品	公司存在购买结构性存款、可转让大额存单的情形，具有风险低的特点，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品
7	拟实施的财务性投资	不存在拟实施的财务性投资

综上所述，公司不涉及在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资。

**二、申报会计师核查意见**

**（一）核查程序**

针对上述事项，申报会计师主要执行了以下核查程序：

1、查阅《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件中关于财务性投资相关的规定，逐项分析核查截至报告期末公司财务性投资情况；

2、查阅公司对外投资相关协议、营业执照、财务报表等资料，通过公开渠道查询被投资企业的工商信息，了解被投资企业的经营范围及主营业务情况等；

3、访谈发行人管理层，了解对外投资的背景、目的、形成过程、具体内容，了解公司最近一期末是否持有金额较大的财务性投资，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日公司投入的财务性投资情况以及发行人未来一段时间内财务性投资安排情况。

## **（二）核查结论**

经核查，申报会计师认为：

1、公司对中科共芯的投资属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资；

2、截至最近一期末公司未持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会前六个月至今公司无新投入和拟投入的财务性投资。

(此页无正文，为深圳中科飞测科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0385号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 王艳  
王艳



中国注册会计师： 李贤君  
李贤君



中国注册会计师： 胡霞  
胡霞



2025年4月11日